# Министерство образования и науки Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ» (НИУ МИЭТ)

Институт нано- и микросистемной техники

# Шитов Дмитрий Игоревич Выпускная квалификационная работа по направлению 11.03.03 «Конструирование и технология электронных средств» Разработка системы вычисления отклонения от заданного курса с активной гиростабилизацией

Студент	 Шитов Д.И.
Научный руководитель	
д. т. н., доцент	 Тимошенков С.П.

### РЕФЕРАТ

Отчет содержит 66 с., 3 ч., 27 рис., 16 табл., 38 ист., 3 прил.

УСТРОЙСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ВЫЧИСЛИТЬ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ЗАДАННОГО КУРСА ДВИЖЕНИЯ; ПЛАТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ СТАБИЛИЗАЦИЮ ПО КРЕНУ И ТАНГАЖУ УСТРОЙСТВА ВЫЧИСЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ КУРСА.

Объектом исследования является система вычисления отклонения от заданного курса с применением активной гиростабилизации.

Цель работы – разработка системы вычисления отклонения от заданного курса с активной гиростабилизацией.

В процессе работы был проведен расчет на надежность, отказоустойчивость, а также расчет собственной частоты колебаний печатной платы устройства активной гиростабилизации.

В ходе работы был разработан технологический маршрут сборки и монтажа устройства гиростабилизации.

Результаты расчетов показали, что разработанное устройство полностью соответствует техническому заданию.

## СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5
ВВЕДЕНИЕ	6
Глава №1. Литературный обзор	7
1.1 Индикаторы отклонения курса	8
1.2 Принцип работы	9
1.3 Сравнение аналогов	11
Глава №2. Конструкторская часть	17
2.1 Устройство активной гиростабилизации	18
2.1.1 Анализ функциональной схемы и выбор каналов связи	18
2.1.2 Разработка схемы электрической принципиальной	23
2.1.3 Разработка топологии устройства	23
2.1.4 Расчёт собственной частоты	26
2.1.5 Расчёт на механическую прочность	28
2.1.6 Расчёт надёжности	29
2.2 Клиент – серверная часть системы	33
2.2.1 Разработка общей схемы реализации	33
2.2.2 Разработка серверной части	35
2.2.2.1 Выбор устройства	35
2.2.2.2 Выбор и настройка ОС	40
2.2.2.3 Разработка серверного ПО	42
2.2.3 Разработка клиентской части	43
2.2.3.1 Разработка функциональной составляющей	43
2.2.3.2 Разработка клиентского интерфейса	44
Глава №3. Технологическая часть	45
3.1 Анализ конструкции ПП и ее конструктивов	46

3.2 Выбор материалов	48
3.2.1 Выбор клеящего материала	48
3.2.2 Выбор припойной пасты	50
3.3 Нанесение припойной пасты	52
3.4 Сборка и монтаж	54
3.5 Контроль качества	59
3.6 Алгоритм сборки и монтажа	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	63
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	64
Приложение А	
Приложение Б	
Приложение В	

### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ДУС — Датчик угловой скорости;

БОИ — Блок обработки информации;

МЭМС — Микроэлектромеханические системы;

ШИМ — Широтно-импульсная модуляция;

АЦП — Аналого-цифровой преобразователь;

ПП — Печатная плата;

САПР — Система автоматизированного проектирования;

ЖКИ — Жидко кристаллический индикатор;

ЭУ — Электронное устройство;

ДУС — Датчик угловой скорости;

ТМК — традиционно-монтируемые компоненты;

ПМК — поверхностно-монтируемые компоненты;

ЭРК — Электро-радио компонент;

КП — Контактная площадка;

САПР — Система автоматизированного проектирования;

КК — Контроль качества;

TП — Технологический процесс;

МК — Маршрутная карта;

ОК — Операционная карта;

IPC — Институт печатных плат (Institute of Printed Circuits);

МЭК(IEC) — международная электротехническая комиссия (International

Electrotechnical Commission);

QFP — Quad Flat Package;

QFN — Quad Flat No-Lead;

### **ВВЕДЕНИЕ**

Одним из направлений развития современных электронных устройств является их интеграция и универсализация. Одним из методов повышения универсальности устройства является интеграция всех необходимых модулей в одно устройство, способное выполнять весь необходимый функционал.

Такая интеграция важна при использовании устройства в не нормальных условиях. В которых от устройства требуются сниженные массогабаритные показатели, повышенная надежность и износостойкость. К таким условиям можно отнести применения устройств на воздушных и водных средствах.

В условиях движения на воздушном или наводном средстве необходимо иметь четкое представление о действительном направлении движения. Это помогает избежать прохождение лишнего пути и, следовательно, уменьшить время и ресурсы на его преодоление.

В рамках дипломной работы ставится задача разработки устройства определения отклонения от заданного курса. А также, изготовление реального образца устройства.

Система указания отклонения от заданного курса содержит два основных модуля, первый – устройство определения отклонения курса, способное передавать расчетные данные принимающим клиентам, второе – гиростабилизатор, который позволяет получать более точное представление отклонения, за счет исключения двух осей движения датчика угловой скорости.

В процесс разработки системы входит: схемотехническое проектирование, расчетное проектирование, разработка программного обеспечения, выбор оборудования и материалов, изготовление опытной конструкции устройства.

Глава №1. Литературный обзор

### 1.1 Индикаторы отклонения курса

Индикатором отклонения курса называется прибор, который указывает отклонение между реальным направлением движения и расчетным. При направлении движения левее заданного курса стрелка прибора сигнализирует об этом, отклоняясь вправо, и наоборот.

Внешне прибор похож на компас, но принципы работы у них совершенно разные. На рисунке 1 представлен пример аналогового прибора.



Рисунок 1 — Аналоговый индикатор указания направления курса В качестве курсоуказателя может использоваться обычный магнитный компас, но его точности недостаточно. На смену магнитным компасам пришли гироскопические, которые в корне поменяли представление о строении точного курсоуказателя.

Данные приборы применяются на водных и воздушных судах для указания отклонения от заданного курса движения. Прибор помогает соблюдать прямолинейное движение в заданном направлении.

Современные курсоуказатели представляют собой сложные системы, в большинстве случаев, состоящие из нескольких логически разделенных блоков:

- 1. Блок обработки информации;
- 2. Блок самого гироскопа;
- 3. Блок визуализации данных;

### 1.2 Принцип работы

Существует несколько разновидностей конструкций указателей курса на основе гироскопа. Принципиальное отличие заключается в типе применяемого гироскопа. К наиболее известным можно отнести:

- на основе жидкостного гироскопа;
- на основе безжидкостного гироскопа;

Гирокомпасы на основе поплавочного гироскопа широко используются для навигационных целей, так как имеют довольно высокую точность. Отличительной чертой таких гирокомпасов является большие массогабаритные показатели за счет его конструкции.

В своем составе такой гирокомпас имеет гироскоп, помещённый внутрь шара, который в свою очередь находится в жидкости. Вес шара с гироскопом таков, что его центр тяжести располагается на оси шара в его нижней части, когда ось вращения гироскопа горизонтальна.

Подобная конструкция является механической и в качестве визуализирующего инструмента выступает аналоговая стрелка, расположенная на конструкции гироскопа.

Совершенно отличная от аналогового гирокомпаса конструкция его электронного аналога. В таком приборе в качестве основного измерительного инструмента выступает гироскоп, выполненный в МЭМС исполнении. Он построен по принципу камертона и работает на эффекте Кориолиса.

Принцип работы такого гироскопа следующий:

Две подвижные массы находятся В непрерывном движении противоположных направлениях. При изменении угловой скорости конструкции, сила Кориолиса будет действовать в перпендикулярном, относительно оси колебаний инерциальных масс, направлении. Эта сила вызовет смещение масс, пропорциональное величине угловой скорости. Электроды(роторы) сенсорной части непосредственной расположенные близости датчика, неподвижным электродам(статоры), образуют конденсатор, емкость которого будет изменяться пропорционально приложенной угловой скорости. Таким образом совершается преобразование механического движения в электрический параметр, который в дальнейшем обрабатывается электрической схемой [1].

После обработки, сигнал поступает в блок обработки информации, который в свою очередь, выполняет визуализацию считанной информации на специальный электронный или аналоговый индикатор.

В современных гирокомпасах применяется как электронный способ отображения информации, с помощью специальных дисплейных модулей, так и аналоговый, подразумевающий пропорциональное изменение угла поворота стрелки.

### 1.3 Сравнение аналогов

Аналогов подобным системам указания отклонения курса в свободной продаже довольно мало. Это связано с достаточно узкой областью применения. Мне удалось найти порядка десятка предложений продажи подобных устройств, большинство из которых поставляются под заказ. Рассмотрим некоторые из них.

### 1. PGM-C-010 производителя ПНППК

Прибор отечественного производителя, разработан для применения на малых судах гражданского флота. Устройство подходит для всех типов судов и является универсальным.

Гирокомпас выполнен в виде моноблока, с пластмассовым корпусом. Чувствительным элементом устройства является прецизионный датчик, способный считывать информацию с частотой до 100 Гц. Обладает высокой точностью измерения курса 0.1 градуса. Оснащен дисплеем, на котором может быть отображена не только информация о текущем курсе, но и скорость, время, а также долгота и ширина.

Устройство не требует обязательного обслуживания и обладает длительным временем наработки на отказ. [2]



Рисунок 2 – Аналоговый индикатор указания направления курса[2]

### 2. Teledyne Meridian производителя Teledyne TSS

Компактный высокоточный гирокомпас, предназначенный для стационарной работы на судне. Не требует дополнительных модулей и может эксплуатироваться в базовой комплектации.

Устройство обладает точным гироскопом, который тщательно защищен от различного рода повреждений монолитным пластмассовым корпусом. Имеет встроенную систему индикации значений, как в цифровом виде, так и в аналоговом.

Система оснащена режимом самодиагностики и самонастройки, поэтому данный гирокомпас крайне прост в использовании. Производитель также обращает внимание, на то, что устройство может быть установлено в любой части судна.

В продаже имеется несколько вариантов комплектации данного гирокомпаса. По внешнему виду отличий между ними нет, но количество возможностей и дополнительных функций существенно разнится.

Особенностью устройства является вариативность его использования. Оно может работать как автономно, так и составе сложной системы, позволяющей существенно расширить диапазон дополнительных функций. [3]



Рисунок 3 – Аналоговый индикатор указания направления курса[3]

### 3. ТG-8000/8500 производителя ТОКІМЕС INC.

Сразу хотелось бы отметить, что производитель подразделяет данный гирокомпас как самый недорогой. Конструкция данного устройства разделена на два блока, первый представляет собой гироскоп, второй пункт обработки данных. Плюс такой конструкции в том, что модуль гироскопа может быть помещен в любую часть судна, он не имеет устройств ввода и вывода информации. Блок обработки информации управляет гироскопом, также к БОИ подключается модуль вывода информации, в данном случае это цифровой дисплейный модуль, который приобретается отдельно.

Гирокомпас многофункционален и имеет ряд преимуществ по отношению к аналогам:

- Функция автоматического исправления ошибок;
- Функция само-калибровки и само-настраивания;
- Низкое энергопотребление;
- Совместимость с различным оборудованием данного производителя, может быть включен в сложную систему;

Минусом данного гирокомпаса является то, что он не подходит для применения на малогабаритных судах. [4]



Рисунок 4 – Аналоговый индикатор указания направления курса[4]

### 4. PGM-CRG-022 производителя ПНППК

Еще один представитель отечественного производителя. Устройство выполняет функции не только гирокомпаса, но и гирогоризонта. Построено на базе твердотельных гироскопов, и предназначен для использования как на мелких, так и на крупных судах.

Конструкция устройства имеет малые габариты. В составе два основных модуля, первый — устройство обработки и снятия данных, второе — цифровое устройство визуализации данных. Корпуса блоков выполнены из пластика, что позволяет сэкономить вес конструкции.

Устройство может обеспечить точность выдачи данных при максимальной скорости поворота в 50 градусов в секунду. Помимо этого, монолитная конструкция БОИ позволяет выдерживать значительные механические воздействия: удары до 10 g; вибрации до 0,7 g.

Производитель заявляет, что срок службы превышает 15 лет, что довольно много, учитывая условия эксплуатации устройства. [5]



Рисунок 5 – Аналоговый индикатор указания направления курса[5]

# Сравним технические характеристики приведенных выше устройств: Таблица 1 – Сравнительная характеристика гирокомпасов[3,4,5]

Параметр	PGM-C-010	Teledyne Meridian	TG- 8000/8500	PGM-CRG- 022
Погрешность измерения, °	0,1	0,1 – 0,3	0,3	0,3
Скорость обработки, °/с	≤ 100	0 - 90	75	50
Диапазон рабочих температур, °C	-15+55	0+45	-10+50	-15+55
Напряжение питания, В	24	24	24	24
Потребляемая мощность, Вт	≤ 100	≥ 72	≤ 240	60
Наличие встроенного устройства визуализации	Да	Да	Нет	Да
Размеры (ДхШхВ), мм	288x240x329	344x267x440	487x182x438	474x174x175
Вес, кг	15.5	15.5	23	11
Продолжительность работы, ч	25000	30000	30000	40000
Страна производитель	Россия	США	Япония	Россия
Стоимость, руб.	850 000	-	970 000	-

По результатам сравнения можно сделать вывод о том, что все приборы гирокомпасов имеют прецизионные характеристики точности измерения. На некоторые устройства не представлено цен, это связано с тем, что приборы доступны к покупке по запросу.

Все представленные устройства различаются по способу визуализации расчетных данных. Некоторые гирокомпасы (Teledyne Meridian и TG-8000/8500) не имеют в своем составе встроенного устройства индикации отклонения, в таких случаях они покупаются отдельно. Гирокомпас PGM-C-010 оснащен аналоговой шкалой, а PGM-CRG-022 имеет в своем составе цифровой дисплейный модуль.

Помимо этого, стоит отметить массогабаритные показатели приведенных устройств. Так как некоторые гирокомпасы поставляются в составе из нескольких блоков, размер в таблице указан в виде их суммы. В составе устройства ТG-8000/8500 не предусмотрен прибор визуализации, его необходимо приобретать отдельно, поэтому размер указан только для блока обработки.

Средняя цена за подобное устройство довольно велика, хотя производители указывают, что все эти гирокомпасы являются бюджетными и обладают низкой стоимостью. Именно поэтому, было принято решение разработать аналог подобного устройства, обладающий подобными характеристиками, но в разы меньшей ценой.

Глава №2. Конструкторская часть

### 2.1 Устройство активной гиростабилизации

### 2.1.1 Анализ функциональной схемы и выбор каналов связи

Разрабатываемое устройство представляет собой программируемую функциональную ячейку, обрабатывающую данные, поступающие с ДУС и формирующие управляющий сигнал для цифровых сервоприводов в зависимости от встроенной в микроконтроллер программы. Функциональная схема проектируемого устройства представлена на рисунке 6.

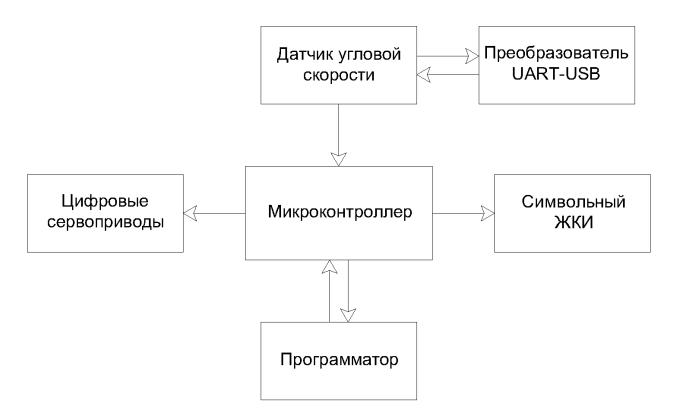


Рисунок 6 - Функциональная схема модуля гиростабилизатора

В качестве управляющего микроконтроллера рассматривались варианты двух архитектур: AVR и ARM Cortex-M3. Пример сравнения характеристик микроконтроллеров той и другой архитектур приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Сравнение микроконтроллеров одного ценового диапазона на архитектурах AVR и ARM [6][7]

Параметры	ATmega8-16AU	STM32F030K6T6
Разрядность	8 бит	32 бита
FLASH	32кб	32кб
SRAM	1кб	4кб
EEPROM	5126 x 8	-
Таймер 8 бит	2	-
Таймер 16 бит	1	16
ШИМ	3 канала	6 каналов
USART	1	1
SPI	1	1
I2C	1	1
АЦП	8 каналов 10 бит	16 каналов 12 бит
Питание	4,5 - 5,5 B	2,4 - 3,6 B
Скорости	0 - 16МГц	48МГц при внешних 4 -
Скорость	0 - 101/11 ц	32МГц
Стоимость	110 руб.	74 руб.

В ходе проведенного сравнительного анализа были выявлены преимущества ARM в аспектах широты спектра используемой периферии и программного управления таймерами, но несмотря на все достоинства я прибегну к использованию МК ATmega8-16PU. Свой выбор я аргументирую только собственным опытом использования этого семейства микроконтроллеров, что значительно повлияет на скорость разработки устройства. К тому-же, производительности и функционала данного микроконтроллера вполне хватает для поставленной задачи.

В итоге, в качестве управляющего микроконтроллера был выбран ATmega8-16PU фирмы Atmel. Его характеристики приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Характеристики микроконтроллера Atmel ATmega8-16AU[6]

Параметры	ATmega8-16AU
Разрядность	8 бит
FLASH	32кб
SRAM	1 кб
EEPROM	5126 x 8
Таймер 8 бит	2
Таймер 16 бит	1
ШИМ	3 канала
USART	1
SPI	1
I2C	1
АЦП	8 каналов 10 бит
Питание	4,5 – 5,5 B
Скорость	16МГц

Также, было рассмотрено несколько вариантов визуализирующих устройств, но учитывая их схожесть, рассматривать характеристики каждого не имеет смысла. Главным критериям выбора был ценовой диапазон и количество строк символов, поэтому был выбран ЖКИ WH1604A-YGH-CT фирмы Winstar. Его характеристики приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Характеристики ЖКИ Winstar WH1604A-YGH-CT[8]

Параметры	WH1604A-YGH-CT
Интерфейс	parallel
Количество символов	16
Количество строк	4
Подсветка	есть
Цвет	Желт/зел
Поддерживаемые шрифты	Рус/англ
Напряжение питания	5 B
Температурный диапазон	расширенный

Так как, ДУС выдает данные по протоколу UART, то именно этот протокол стал основным для обмена информацией с датчиком.

Интерфейсом прошивки микроконтроллера был выбран стандартный интерфейс ISP. Структурная схема прошивки МК приведена на рисунке 7 [9].

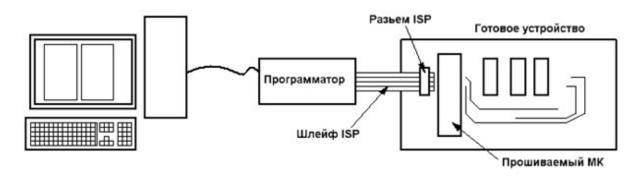


Рисунок 7 - Структурная схема программирования МК [9]

В качестве программатора используется ранее сконструированное устройство AVR-910, которое позволяет осуществлять как внутрисхемное, так и раздельное программирование МК.

В качестве ДУС был выбран прецизионный гироскоп МГ-10-111-Р ввиду своей надежности и гибкости настраиваемых параметров.

Таблица 5 - Основные характеристики прецизионного ДУС МГ-10-111-Р[10]

Характеристика	Мин.	Ном.	Макс.
Диапазон рабочих температур	-50°C	-	+85°C
Напряжение питания	4,5 B	-	5,5 B
Потребляемый ток	-	-	0,1 A
Скорость передачи данных по UART	115,200 кбит/с	-	3000 кбит/с
Частота обновления данных	-	1 кГц	5 кГц
Диапазон измерения угловой скорости		±75	

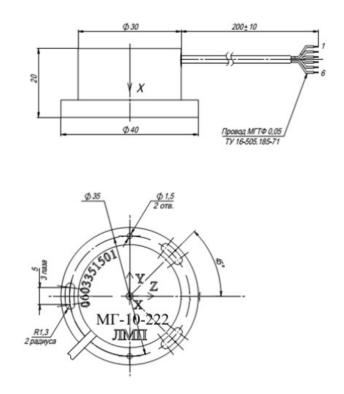


Рисунок 8 - Корпус МГ-10-111-Р [10]

Итоговая структурная схема имеет следующий вид:

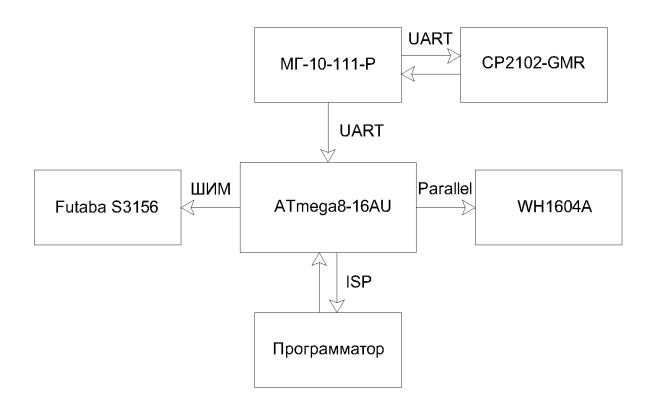


Рисунок 9 - Структурная схема модуля гиростабилизатора

### 2.1.2 Разработка схемы электрической принципиальной

После успешного выбора основных структурных элементов на основании рекомендаций производителей была разработана схема электрическая принципиальная. Определяющими факторами при разработке были обеспечение заданного функционала, наличие индикации передачи данных для удобства отладки и минимизация номенклатуры используемых компонентов. (см. ЭЗ и ПЭЗ).

### 2.1.3 Разработка топологии устройства

Проектирование топологии ПП есть переход от схемной информации (схемы электрической принципиальной) к геометрической информации (размещению в поле чертежа печатной платы элементов схемы и созданию рисунка проводников, соединяющих эти элементы). Одновременно это переход от модельного описания проектируемого изделия к описанию реальной физической его реализации. Только на этом этапе станут известными реальные характеристики проводников, их длина, ширина, площадь и, следовательно, их емкость, сопротивление и индуктивность, что в конечном счете определит ряд важнейших характеристик изделия, например, его быстродействие [11].

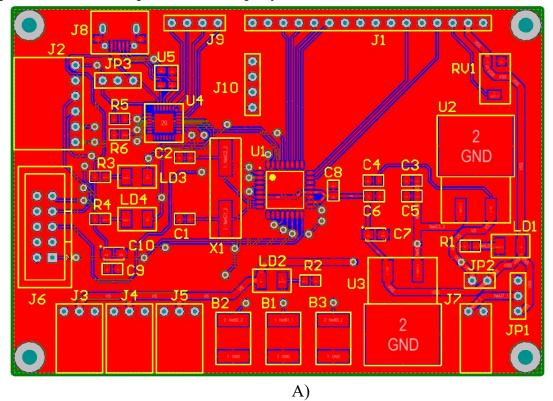
Разработка топологии ПП состоит из двух основных этапов:

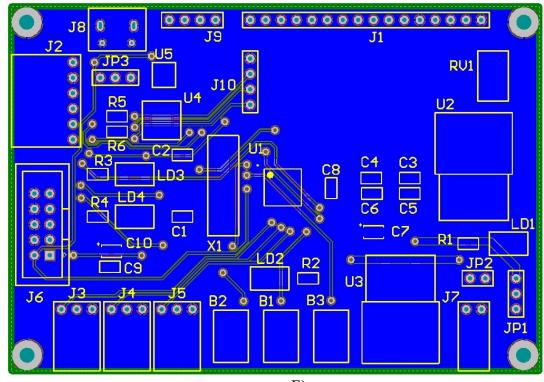
- размещение элементов;
- разводка соединений.

Размещение элементов — это задача определения их местоположения на плате. Размещение должно быть таким, при котором создаются наилучшие условия для решения последующей задачи трассировки соединений с учетом конструктивнотехнологических требований и ограничений.

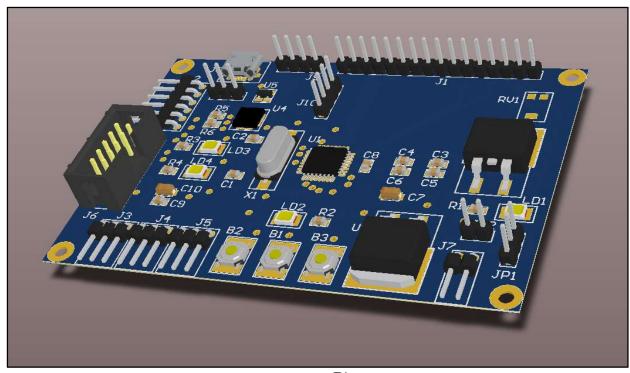
Трассировка монтажных соединений — это задача геометрического построения на плате всех цепей, координаты начала и конца которых определены при размещении элементов. При этом необходимо учитывать различные конструктивно-технологические ограничения (допускаются пересечения или нет, возможен ли переход со слоя на слой, сколько слоев отводится для трассировки, допустимые ширина проводников и расстояния между ними и т. д.) [11].

В качестве САПР для разработки топологии была выбрана освоенная ранее САПР Altium Designer, обеспечивающая достаточное удобство решения обеих вышеуказанных задач для двухсторонней печатной платы, а также возможность моделирования параметров схемы. Эскиз печатной платы, разработанной в данном программном пакете, представлен на рисунке 10.





Б)



B)

Рисунок - 10 Топология печатной платы, выполненная в программе Altium Designer 14.3

А) Лицевая сторона, Б) Обратная сторона, В) 3D-визуализация печатной платы с смонтированными компонентами

### 2.1.4 Расчёт собственной частоты

В наши дни очень важно учитывать влияние внешних вибрационных воздействий для увеличения срока эксплуатации изделия. В печатной плате возникают вынужденные колебания, именно поэтому сама конструкция печатной платы является механическим резонатором.

Для нормальной, продолжительной работы изделие должно соответствовать общеклиматическим условиям работы аппаратуры. На портативную аппаратуру может, без ущерба конструкции, воздействовать вибрация частотой до 20 Гц с ускорением до 2g и удары до 10g при длительности 5...10мс.

Значения диапазона спектра резонансных частот ПП зависят от конкретных особенностей, таких как: форма, размер, применяемые материалы, условия закрепления и т.д. [12].

При проведенных расчетах ПП рассматривается как жесткое основание с имеющимися граничными условиями. В конструкции изготовленного РЭУ на печатной плате расположены радиоэлементы, поэтому, для учета нагрузки введен балансный коэффициент общей массы компонентов.

При расчете ПП принято вводить некоторые допущения:

При расчете пластин обычно принимают следующие допущения:

- деформация на изгиб ПП при колебаниях крайне мала, учитывая толщину платы.
- плата обладает неизменной толщиной, определенной в процессе её изготовления;
- в конструкции платы имеется слой, который не подвергается деформациям растяжения сжатия, при перпендикулярных относительно поверхности платы колебаниях;
- материал конструкции платы имеет изотропную однородность и полную упругость;
- все силы, приложенные к плате, имеют строго перпендикулярное, по отношению к поверхности платы, направление, как до приложения, так и после [12].

Таблица 6 - Исходные данные для расчёта собственной частоты пластины

Материал ПП	Габаритные размеры, мм	Способ закрепления	Модуль упругости, E * 10 <sup>10</sup> , H/м <sup>2</sup>	Коэффициент Пуассона, <i>v</i>	Плотность $\rho*10^3$ , $\kappa \Gamma/M^3$
СТЭФ-1	87x60x1,2	Точечный (n=4)	3,4	0,279	2,47

Общая масса компонентов, расположенных на ПП составляет 19 г.

Расчетное уравнение колебаний ПП рассматривается при следующих условиях:

- вся нагрузка на ПП распределена однородно по всей ее поверхности;
- жесткость всех элементов и проводников постоянна и неизменяема.

Учитывая массу и способ закрепления всех компонентов на плате, воспользуемся методом Ритца [12]:

Расчет жесткости платы:

$$D = \frac{E * h^3}{12\sqrt{(1 - \upsilon^2)}} = \frac{3.4 * 10^{10} * (1.2 * 10^{-3})^3}{12\sqrt{(1 - 0.279^2)}} \approx 5.1 \text{ H * M}$$

Расчет массы (приведенной) для учета массы компонентов, закрепленных на плате:

$$m_{\rm пр} = \rho h + \frac{m_{
m 9}}{ab} = 2,47 * 1,2 + \frac{19 * 10^{-3}}{0,087 * 0,06} \approx 6,6 \ {
m KF/M}^2$$

Используя четырехточечное закрепление платы, определим частоту собственных колебаний платы:

$$f_{
m H} = \left(rac{1}{a^2} + rac{1}{b^2}
ight) \cdot \sqrt{rac{D}{m_{
m np}}} = \left(rac{1}{0.087^2} + rac{1}{0.06^2}
ight) \cdot \sqrt{rac{5.1}{6.6}} pprox 360 \ \Gamma$$
ц

Для возникновения резонанса необходимо воздействовать на плату частотой, равной собственной, что при настоящих условиях эксплуатации практически невозможно. Это подтверждает нормальную работоспособность устройства в заданных условиях.

### 2.1.5 Расчёт на механическую прочность

На протяжении эксплуатации устройство подвергается различным внешним воздействиям: удары, вибрации и т.д. Для защиты от них применяются различные защитные механизмы. Одним из видов защиты является предотвращение отказа устройства, вызванное воздействием механических нагрузок. Для этого проведем точный расчет на прочность при воздействии вибрационных нагрузок.

Некоторые возможные виды разрушений:

- отслоение проводящих дорожек;
- обрыв, отслоение контактных площадок;
- деформация крепежа;
- нарушение герметизации;
- расслоение многослойной ПП [12];

Степень защиты ЭУ от механических воздействий зависит от прочности применяемых компонентов и способа их закрепления на печатной плате. Наиболее вредными для ЭУ воздействиями являются вибрационные.

Допустимой амплитудой A при вибрационных воздействиях, считаем величину не превышающую 0,3 мм и виброскорость  $V_0 \le 800$ мм/с.

Амплитуда колебаний напрямую зависит от частоты и виброперегрузки. Величина виброперегрузки согласно техническому заданию равна 15g.

Конструкция ячейки обладает способностью демпфировать внешние колебания. Поэтому при работе в обычном режиме амплитуды колебаний компонентов ЭУ весьма малы. Они возрастают до опасной величины только при резонансе [12].

При резонансе амплитуда колебаний компонентов возрастает в  $\beta$  раз по сравнению с амплитудой внешних колебаний. Коэффициент  $\beta$  определяется

демпфирующими свойствами ячейки. Коэффициент  $\beta$  примем равным 25, поскольку основными элементами ячейки являются интегральные схемы, приклеенные к печатной плате.

Допустимой амплитудой колебаний при резонансе является  $A_{\theta} = 0,3$  мм. При такой амплитуде, устройство будет сохранять работоспособность даже в условиях резонанса.

Определим минимальную собственную частоту устройства, при которой амплитуда колебаний при резонансе не превысит допустимую.

$$f_{clco6} = \sqrt{\frac{\beta ng}{4\pi^2 A_0}} \left[ \Gamma \mathbf{I} \right];$$

$$f_{c1c06} = \sqrt{\frac{\beta ng}{4\pi^2 A_0}} = \sqrt{\frac{25\cdot15\cdot10}{4\cdot9.86\cdot3\cdot10^{-4}}} = 562 \ \Gamma$$
ц;

Определим минимально допустимую частоту изделия из условий вибростойкости при резонансе:

$$f_{c2co\delta} = \frac{\beta ng}{2\pi V_0};$$

$$f_{c2co6} = \frac{\beta ng}{2\pi V_0} = \frac{25\cdot15\cdot10}{2\cdot3,14\cdot0,8} = 746 \,\Gamma\text{U};$$

Вибропрочность изделия будет оптимальной, когда частота ячейки превысит максимальную из рассчитанных:

$$f_{co6} = 360 \, \Gamma$$
ц  $< f_{c2co6} = 746 \, \Gamma$ ц;

По результатам расчета вибропрочности можно сделать вывод: заданная в техническом задании вибропрочность соблюдается.

### 2.1.6 Расчёт надёжности

Надежностью устройства называется его свойство сохранять нормальную работоспособность с течением времени в заданных условиях эксплуатации. Расчет надежности проводится на этапе проектирования устройства после выбора компонентной базы, составления схемы электрической принципиальной и проектировки условной конструкции изделия. Её проводят с целью определения

требований продолжительности работоспособности изделия установленной техническим заданием [12].

При расчете необходимо учитывать следующие условия:

- все отказы работоспособности компонентов являются случайными;
- все однотипные элементы имеют одинаковую надежность;
- учитывается надежность компонентов, непосредственно применяемых в функциональной схеме устройства;
  - не применяется резервирование [12];

Для расчета надежности вводится поправочный коэффициент  $K_{\lambda}$ , который учитывает интенсивность отказа изделия в лабораторных и реальных условиях эксплуатации:

$$\lambda_i = \lambda_{iH} K_{\lambda}$$
,

где  $\lambda_{jH}$  — интенсивность отказов компонентов в лабораторных условиях работы системы (T=20 °C,  $K_H=1$ ).

Поправочный коэффициент иллюстрирует то, что в реальных условиях эксплуатации отказов может быть значительно больше чем в лабораторных. Значения этих коэффициентов приведены в таблицах.

Таблица 7 - Значения  $K_{\lambda l}$  при механических воздействиях[12]

Условия	Поправочные коэффициенты $K_{\lambda I}$			
эксплуатации	ации При вибрации При ударах	При суммарном воздействии		
Лабораторные	1,00	1,00	1,00	
Стационарные	1,04	1,03	1,07	
Автомобильные	1,35	1,08	1,46	
Железнодорожные	1,40	1,10	1,54	
Корабельные	1,30	1,05	1,37	
Самолётные	1,46	1,13	1,65	

Таблица 8 - Значения  $K_{\lambda 2}$  при различных температурах и относительной влажности[12]

Относительная влажность, %	Температура, °С	Значения коэффициента $K_{\lambda 2}$
60-70	20-40	1,0
90-98	20-25	2,0
90-98	30-40	2,5

Таблица 9 - Зависимость  $K_{\lambda 3}$  от высоты[12]

Высота, км	$K_{\lambda 3}$	Высота, км	$K_{\lambda 3}$
0-1	1,0	8-10	1,25
1-2	1,05	10-15	1,30
2-3	1,10	15-20	1,35
3-5	1,14	20-25	1,38
5-6	1,16	25-30	1,40
6-8	1,20	30-40	1,45

Исходными данными для расчёта являются:

- число узлов (блоков, компонентов) ЭВС;
- число компонентов в узлах;
- интенсивность отказов компонентов.

Учитывая цели и условия эксплуатации изделия, все поправочные коэффициенты используем для нормальных условий.

Учитывая данные таблиц 6-8, для данных технического задания вычисляем:

$$K_{\lambda} = 2,575;$$

Для удобства работы с данными, составим таблицу, в которой приведем табличные данные для каждого типа компонентов, а также результаты промежуточных вычислений.

Таблица 10 - Промежуточные вычисления

Название, тип элементов	Число элементов, $n_i$	Интенсивность отказов, $\lambda_{j\mu} \cdot 10^{-6}$ , ч <sup>-1</sup>	Интенсивность отказов, $\lambda_j \cdot 10^{-6}$ , ч <sup>-1</sup>	$n_i$ · $\lambda_j$ · $10^{-6}$ , $\mathrm{H}^{-1}$
Конденсаторы керамические	8	0,15	0,386	2,778
Конденсаторы танталовые	1	0,6	1,545	1,545
Резисторы SMD	7	0,03	0,07725	0,618
Полупроводниковые интегральные микросхемы	2	0,02	0,0515	0,103
Светоизлучающие диоды SMD	4	0,2	0,515	2,06
Кварцевые резонаторы	1	0,02	0,0515	0,0515
Плата печатной схемы	1	0,7	1,8025	1,8025
Автоматическая пайка	107	0,002	0,00515	0,55105
Ручная пайка	20	0,2	0,515	10,3
Переключатель кнопочный	3	0,07	0,18025	0,18025

Суммарная интенсивность отказов:

$$\lambda_{C} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{n_{i}} \lambda_{j} = 19,99 * 10^{-6} \text{y}^{-1}[6];$$

Вероятность безотказной работы:

$$P_C(t) = \exp(-t * \lambda_C) = \exp(-5000 * 20 * 10^{-6}) \approx 0.905;$$

Среднее время безотказной работы:

$$T_C = \frac{1}{\lambda_C} = \frac{1}{19,99 * 10^{-6}} = 50001 \,\mathrm{ч}$$

По результатам проведенных расчетов, можно сказать что значение среднего времени безотказной работы изделия соответствует техническому заданию.

### 2.2 Клиент – серверная часть системы

### 2.2.1 Разработка общей схемы реализации

Клиент – серверная часть – это система, которая выполняет функцию обработки и передачи информации о значении отклонения от заданного курса. Система разделена на два основных модуля: серверное и клиентское устройство.

Серверная часть должна выполнять следующие функции:

- Чтение данных с ДУС;
- Преобразование данных в числовой формат;
- Проверка корректности данных;
- Отправка данных клиентам;

### Клиентская часть:

- Прием данных от сервера;
- Визуализация данных;
- Динамическое изменение визуального отображения;

В процессе проектировки данной системы было важно учесть некоторые требования технического задания:

- 1. Беспроводная работа клиентского устройства в пределах 10-30 метров;
- 2. Поддержка питания от аккумулятора 5В и низкое энергопотребление;
- 3. Возможность удаленного обновления системы;
- 4. Компактность и мобильность;

Первым делом, необходимо составить общую структурную схему систему и описать основные модули системы. На рисунке 11 представлена структурная схема.

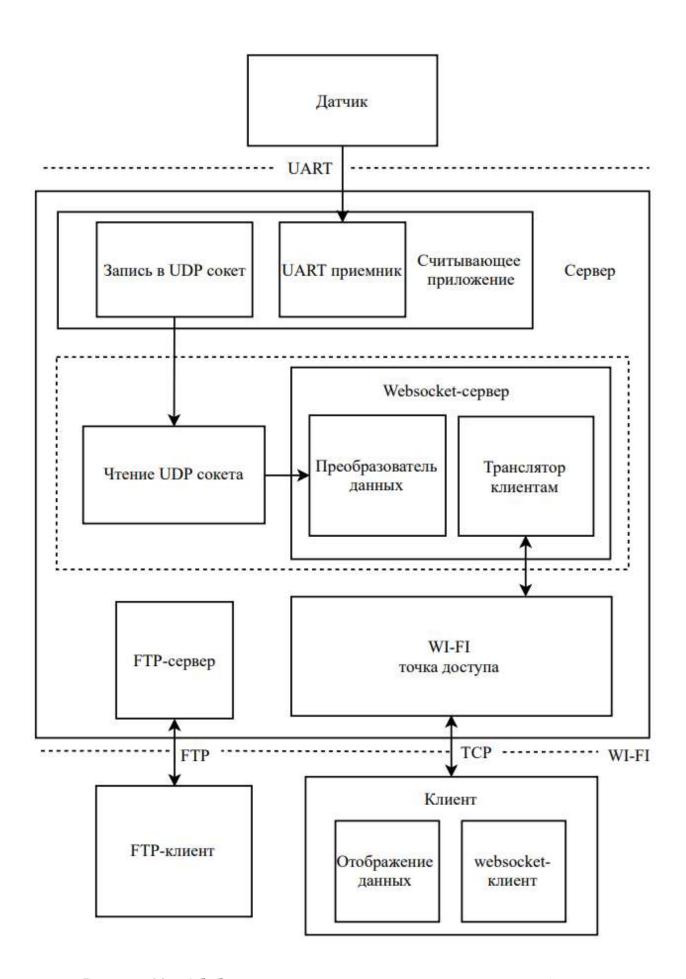


Рисунок 11 — Обобщенная структурная схема клиент-серверной части

Как видно из вышеприведенной схемы, система состоит из трех функциональных модулей, первый – датчик угловой скорости, второй – серверное устройство и третий – клиентское устройство.

В качестве датчика используется МГ-10 (рисунок 8), его параметры приведены в таблице 8. Датчик одновременно задействован в двух устройствах, данные дублируются на оба модуля.

Сервер – устройство, которое выполняет функцию чтения данных и трансляции их клиентам, находящимся в одной подсети с ним. В данном случае, функционал сервера разбит на логические модули:

- программа чтения данных с ДУС;
- программа, преобразования данных в числовой формат и отправки их клиентам;
- программа, обеспечивающая соединение с клиентами;

Также, имеются некоторые сервисные части, такие как FTP-сервер, который позволяет управлять файловой системой серверного устройства для удобства отладки программного кода.

### 2.2.2 Разработка серверной части

### 2.2.2.1 Выбор устройства

Как уже говорилось выше, сервер - это сложное устройство, которое должно обеспечивать весь необходимый функционал. В нашем случае, имеет смысл использовать персональный компьютер в качестве такого устройства, но он имеет неприемлемые массогабаритные показатели, а также, его производительность будет избыточной для поставленной задачи. Отличным решением будет применение миникомпьютера, который вполне может справиться с поставленными задачами, и обладает малой массой и габаритами.

Сегодня на рынке миникомпьютеров большой выбор устройств, цена которых не превышает 3-4 тыс. рублей. Разные производители предлагают свой продукт с впечатляющими характеристиками. Далее будут рассмотрены 3 представителя семейства миникомпьютеров, подходящих для решения наших задач.

### 1. Raspberry PI 3 производителя RASPBERRY PI FOUNDATION

Исторически первый представитель семейства миникомпьютеров, появился на рынке электронных устройств в 2011 году. С тех пор, имеется серия устройств данного производителя, предназначенных для разных задач и имеющие разные параметры и габариты.

Отличительной чертой данного устройства является компактность и большое количества дополнительной периферии. Компьютер построен на процессоре Cortex-A-5 частотой 1.2 ГГц, имеет 1 Гб оперативной памяти типа LPDDR2 и все необходимые периферийные устройства [13].

Устройство работает на операционной системе Linux, как и все представители данного сегмента. Плата устройства имеет габариты 85х49, что сопоставимо с размерами кредитной карточки. Внешний вид одноплатного компьютера представлен на рисунке 12.



Рисунок 12 – Одноплатный компьютер Raspberry PI 3 Model B[13]

Данный вариант, вполне подходит для использования его в качестве сервера, учитывая его цену, порядка 3000 рублей.

## 2. BeagleBone Black производителя BeagleBoard

Второй представитель одноплатных миникомпьютеров, построен на процессоре ARM Cortex-A8, работающего на частоте 1 ГГц. Оснащен оперативной памятью eMMC в размере 512 Мб и встроенным видео-ускорителем. Имеет все популярные периферийные модули. Недостатком данного миникомпьютера является отсутствие встроенного WI-FI адаптера.

Устройство работает на ядре операционной системы Linux и совместим с большинством популярных дистрибутивов.

Питание устройства осуществляется от источника постоянного тока 5 В и энергопотребление в рабочем состоянии может достигать 2,5 А, что сопоставимо с аналогами и является нормой для семейства подобных устройств.

Данный персональный компьютер является менее распространенным чем его ближайший аналог Raspberry PI, в первую очередь это связано с завышенной производителем ценой, которая составляет порядка 7500 рублей [14].

На рисунке 13 представлен внешний вид устройства.

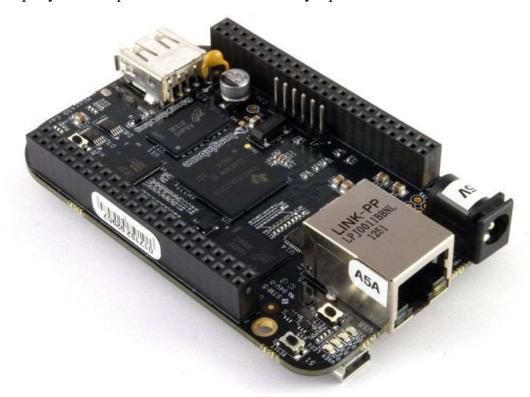


Рисунок 13 – Одноплатный компьютер BeagleBone Black[14]

Недостатками устройства является: отсутствие встроенного WI-FI адаптера и высокая цена относительно конкурентов.

## 3. ODROID-C1 + производителя Hardkernel

Еще один представитель одноплатных миникомпьютеров внешне очень похож на более популярного конкурента — Raspberry PI 3. Но, в отличие от RPI является более производительным. В первую очередь, это связано с относительно мощным процессором Cortex-A5, работающий на частоте 1,5 ГГц. Устройство оснащено оперативной памятью типа DDR3 в размере 1 Гб. Также в его составе имеется видеопроцессор Mali-450, работающий на частоте 600 МГц, что позволяет устройству без проблем работать с графической оболочкой [15].

Устройство питается от источника постоянного напряжения 5В и по заявлению производителя в период активной работы потребляет ток порядка 2A.

Но более мощный процессор, это не единственный плюс. К достоинствам миникомпьютера можно отнести поддержку еММС модули памяти, которые значительнее быстрее стандартных micro-SD карт. Помимо этого, устройство обладает привлекательной ценой, которая составляет приблизительно 3500 рублей.

Присутствует поддержка операционных систем семейства Linux.

На рисунке 14 представлен внешний вид устройства.



Рисунок 14 – Одноплатный компьютер ODROID-C1 +[15]

В таблице 11 сведены основные характеристики рассмотренных устройств. Таблица 11 – Сравнительная характеристика миникомпьютеров[13,14,15]

Параметр	Raspberry PI 3	BeagleBone Black	ODROID-C1 +
Процессор	ARM Cortex-A5	ARM Cortex-A8	ARM Cortex-A5
Процессор	1.2 ГГц	1 ГГц	1.5 ГГц
Видеопроцессор	VideoCore 4	POWER SGX530	Mali-450
Видеопроцессор	250 МГц	200 МГц	600 МГц
ОЗУ	DDR2 512 M6	DDR3L 512 Мб	DDR3 1 Гб
039	400 МГц	700 МГц	800 МГц
Поддержка ПЗУ	microSD	microSD	
USB порты	4	1	4
Ethernet	+	+	+
WI-FI	+	-	+
Питание	5B 2A	5B 2,5A	5B 2A
Поддерживаемые ОС	Linux	Linux	Linux
Габариты (ДхШ), мм	85x49	86x53	82x58
Цена, руб.	3000	7500	3500

По результатам обзора рынка одноплатных компьютеров, можно сделать вывод: продукты все схожи, и различаются лишь в габаритах и количестве встроенных периферийных модулей. Так как, ранее я имел опыт работы с компьютером Raspberry PI, свой выбор я остановлю именно на нем. К тому-же, он обладает оптимальными массогабаритными и ценовыми показателями.

## 2.2.2.2 Выбор и настройка ОС

Перед разработкой программного обеспечения, необходимо настроить устройство. Выбор операционной системы и ее настройка является важнейшей частью, ведь именно эта операция определяет дальнейшую стабильность работы всей системы.

Выбранное мной устройство, которое будет задействовано в качестве сервера, поддерживает только системы на основе ядра Linux. Это является больше плюсом, чем минусом, так как работа с семейством этих операционных систем не вызывает особых затруднений.

Рассмотрим основные, наиболее популярные, поддерживаемые устройством дистрибутивы:

- Ubuntu;
- Raspbian;

Сборка Ubuntu 16.04 LTS полностью совместима с RPI, и процесс ее настройки не занимает значительного времени. Дистрибутив поддерживает работу с графической оболочкой, что в нашем случае не имеет большого значения, так как в дальнейшем будет использоваться только терминальная, базовая версия без графического ядра. ОС предназначена для использования как на рабочих станциях, так и на серверном оборудовании и имеет в своем составе все необходимые компоненты для серверной реализации.

Процесс установки тривиальная задача, поэтому он не будет описан в рамках ВКР.

Забегая вперед, отмечу, что первоначально на серверное устройство был установлен именно дистрибутив Ubuntu. Все ПО разрабатывалось именно под этой сборкой, но отладка показала, что, загрузка системы длится довольно продолжительное время, порядка 1-1,5 минуты, что неприемлемо техническим заданием. Именно поэтому было принято решение установки другого дистрибутива Raspbian.

На сайте производителя Raspberry PI, разработчик устройства советует использовать именно сборку Raspbian, так как она предназначена для использования именно под этими устройствами. Дистрибутив имеет полную поддержку аппаратной части RPI и может использоваться без графической оболочки, что нам на руку, так

как такой способ экономит ресурсы устройства. Остановимся на выборе дистрибутива Raspbian.

Настройка операционной системы нетривиальная задачи и поэтапный процесс можно найти на моей странице Github. Его разработка велась в процессе создание первого опытного образца устройства. Данное описание может быть использовано для простоты повторяемости конструировании устройства. В рамках ВКР я не буду описывать весь процесс, а опишу лишь настройку в общей форме.

Первым делом необходимо установить серверный набор утилит LAMP. Он включает набор программ необходимых для работы сервера. Он включает свободный веб-сервер Арасhe, который является основной и обязательной утилитой.

Вторым шагом необходимо установить программное обеспечение FTPсервера. Данное ПО используется с целью упрощения отладки серверного программного обеспечения. Позволяет без проблем управлять файловой системой устройства с другого персонального компьютера.

Также, необходимо настроить работу устройства по сетевому протоколу SSH. Это позволит удаленно управлять операционной системой с другого ПК. Это особенно удобно при работе устройство без графической оболочки, в терминальном режиме.

Следующим шагом будет настройка точки доступа WI-FI. Устройство в своем составе имеет встроенный WI-FI адаптер, который может работать не только на прием сигнала, но и на его раздачу. Точка доступа необходима для беспроводного соединения с клиентами. Процесс подробной настройки можно найти на моей странице Github.

Остался заключительный этап настройки операционной системы — формирование конструкции каталогов в папке веб-сервера.

После окончания процесса настройки, можно перейти в разработке серверного программного обеспечения.

## 2.2.2.3 Разработка серверного ПО

Начальным этапом разработки любого серверного приложения является выбор языка программирования. Я ранее работал с языком PHP (HyperText Preprocessor), поэтому при разработке серверной части я буду пользоваться именно им. Язык является самым распространенным в мире и все веб-серверы поддерживают его интерпретирование.

Для начала необходимо определиться с протоколом, с помощью которого возможна потоковая передача значений угловой скорости в реальном времени. Одним из наиболее популярных протоколов, удовлетворяющих требованиям, является WebSocket. Для работы с ним, воспользуемся готовым решением, которое называется websocket server.

Вторым шагом, необходимо определить, каким образом будут считываться данные с ДУС. Существует два способа:

- Считывать данные непосредственно языком РНР;
- Использовать для считывания внешнее приложение, написанное на С++;

Сразу хотелось бы уточнить, что в процессе разработки были реализованы оба этих способа и опытные испытания показали, что внешнее приложение справляется с поставленной задачей значительно быстрее, к тому-же, использует меньший объем ресурсов миникомпьютера RPI.

Внешнее приложение чтения данных с датчика выполняет чтение данных в шестнадцатеричном формате и передает их, без преобразования, через UDP сокет, websocket серверу. Далее данные преобразуются в десятичный формат и отправляются подключенным клиентам. Частота отправки колеблется в пределах 20 пакетов в секунду, такое количество данных может обеспечить плавность хода стрелки на шкале отклонения от заданного курса.

Помимо этого, во внешнем приложении осуществляется проверка корректности принятых с ДУС данных. Алгоритм расчета контрольной суммы имеет название CRC32 и является наиболее распространенным. Данная проверка позволяет отфильтровать данные, которые были искажены в процессе передачи внешними наводками и несовершенством проводящих линий.

## 2.2.3 Разработка клиентской части

Клиент — устройство, которое связывается с сервером по беспроводному каналу связи WI-FI и в непрерывном цикле получает числовые значения о значении угловой скорости в данный момент.

В качестве клиента может выступать любое современное мобильное устройство, будь то ноутбук или смартфон. Основной упор сделан на мобильных клиентов. Все современные устройства имеют предустановленный браузер, который в нашем случае и будет выступать для общения с сервером.

Разработка веб-приложений основывается на трех основных языках программирования и разметки.

- Язык разметки HTML (HyperText Markup Language);
- Каскадные таблицы стилей CSS (Cascading Style Sheets);
- Язык программирования JavaScript;

## 2.2.3.1 Разработка функциональной составляющей

Функциональная составляющая веб-приложения разрабатывается с применением высокоуровневого языка программирования JavaScript. Помимо этого, анимирование объектов веб-страницы, также создается с применением этого языка.

В первую очередь необходимо создать конструкцию, которая бы осуществляла обмен информацией с сервером. Ранее было сказано, что для передачи потоковой информации о значении текущего курса, будет использован протокол полудуплексной связи WebSocket. После того, как обмен данными с сервером успешно налажен, необходимо создать методы, которые бы помещали принятую от сервера информацию в ранее сверстанные блоки каркаса приложения. Для языка JavaScript создана, упрощающая, и делающее код более читабельным библиотека JQuery. Она позволяет JS без проблем взаимодействовать с каркасом приложения. Далее, необходимо добавить функционал всем управляющим элементам, таким как кнопки и «ползунки».

После окончания разработки функционала у нас получилось кросс-браузерное приложение, которое будет корректно работать на всех типах мобильных устройств.

## 2.2.3.2 Разработка клиентского интерфейса

Дизайн клиентского приложения разрабатывается с применением языка разметки веб-страницы HTML и каскадных таблиц стилей CSS. Порядок разработки следующий:

- Создание каркаса приложения, этот процесс имеет альтернативное название- вёрстка;
- Придание всем свёрстанным элементам стилевого оформления, путем указания стилевых параметров в файле CSS;

При создании интерфейса также использовался язык разметки векторной графики SVG (Scalable Vector Graphics) для создания индикатора изменения направления курса.

В приложении предусмотрены две цветовые темы оформления.

В результате работы получился интерфейс, представленный на рисунке 15.





Рисунок 15 — Внешний вид главного окна пользовательского интерфейса в двух различных цветовых оформлениях

Глава №3. Технологическая часть

#### 3.1 Анализ конструкции ПП и ее конструктивов

Для разработки ТП сборки и монтажа следует проанализировать конструкцию изделия и предъявляемые к нему требования.

Применительно к конструкции изделия можно отметить следующие особенности:

- Сборка и монтаж компонентов на плату осуществляется с обоих сторон, но размещаются ПМК и ТМК только с верхней стороны;
- Производство мелкосерийное, следовательно, все технологическое оборудование должно быть универсальным, обеспечивать возможность производства широкой номенклатуры изделий, удовлетворять ценовым показателем;
- Специальных требований к изделию не предъявляется, требования к качеству и надежности соответствуют классу А (изделия общего назначения) согласно ГОСТ Р МЭК 61191-1-2010;

На основе топологии ПП, а также перечня элементов и схемы электрической принципиальной, необходимо провести анализ используемой компонентной базы. Особое внимание стоит уделить сборке и монтажу следующих компонентов: микроконтроллер U1, микросхема преобразователя U4, стабилизаторы напряжения U2, U3, разъем micro USB-B, различные чип-компоненты.

Микроконтроллер ATmega8-16PU производителя Atmel в корпусе QFP-32 с шагом выводов 0,8 мм (рисунок 15(а)). Большое число выводов и относительно малый шаг данной микросхемы требуют тщательного контроля после монтажа (возможно образование перемычек припоя, смещений).

Микросхема преобразователя USB-UART CP2102 производителя Silicon Laboratories в корпусе QFN-28 имеет большое количество выводов с шагом 0,5 мм, кроме того, выводы расположены под корпусом микросхемы (рисунок 15(б)). Из-за маленького шага выводов, микросхема требует точного позиционирования, а также обязательного контроля после монтажа. Кроме того, у микросхемы есть теплоотвод, спрятанный внизу корпуса, требующий качественного монтажа на КП платы. Следует учесть, что, не стоит под данный компонент наносить клей в процессе

сборки. Микросхему можно закрепить клеем по углам, на которых нет электрических контактов.

Стабилизаторы напряжения L7805ABD2T-TR в корпусе d2раk (рисунок 15(в)). Особенностью монтажа данных компонентов является то, что у них имеется массивный теплоотводящий радиатор, который требует качественного монтажа на ПП. В месте крепления радиатора необходимо четко соблюдать количество наносимой припойной пасты. Возможны такие дефекты, как: образование пустых воздушных областей под корпусом, препятствующих нормальному теплоотводу, и смещение корпуса.

Разъём micro USB-В имеет варианты как поверхностного, так и традиционного монтажа (рисунок 15(г)). На плате предусмотрены оба варианта монтажа компонента, предпочтительным является вариант традиционного монтажа в отверстия. Перед сборкой, компонент необходимо подготовить, отогнув (если этого не сделано) контакты к корпусу. На компонент будут воздействовать серьезные механические воздействия, поэтому он требует надежного соединения с ПП и точной установки.

Чип-компоненты типоразмеров 0805, 1206 по МЭК (рисунок 16). Из-за малых размеров на чип-компоненты значительное влияние оказывают силы поверхностного натяжения в расплавленном припое. После оплавления припоя компоненты могут оторваться одним из своих контактов от контактной площадки платы (дефекты типа «надгробного камня»). При ручной сборке чип-компонентов высока вероятность появления дефектов смещения, поэтому следует уделить большее внимание КК монтажа компонентов.

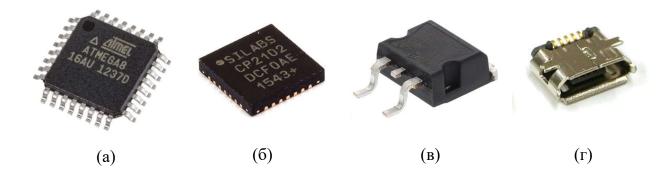


Рисунок 15 — Компоненты - микроконтроллер ATmega8-16PU в корпусе QFP-32 под (а), преобразователь USB-UART CP2102 в корпусе QFN-28 под (б), стабилизатор напряжения L7805ABD2T-TR в корпусе d2pak под (в), разъём micro USB-В для поверхностного монтажа под (г) [16]

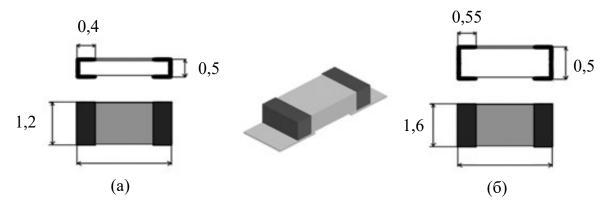


Рисунок 16 – Габариты чип компонентов (мм) – типоразмера 0805 под (а) и типоразмера 1206 под (б)

Из обзора компонентной базы следует, что ТП сборки и монтажа рассматриваемого изделия, должен содержать не только сборку и монтаж ПМК и ТМК на плату, но и операции контроля качества после каждой операции. Такой подход позволит увеличить процент выхода годных изделий, а, следовательно, и снизить производственные затраты.

## 3.2 Выбор материалов

#### 3.2.1 Выбор клеящего материала

Для монтажа компонентов используются клеящие материалы на основе эпоксидной смолы и силикона. Клеящие материалы разделяются на следующие категории:

- Термореактивные клеи. Затвердевание клея происходит на плате под действием теплоты. После затвердения имеют большую прочность и сохраняют ее при повышении температуры. Выпускаются в виде готовой однокомпонентной смеси, в которой присутствует отвердитель и эпоксидная смола, или двухкомпонентной смеси, которые необходимо смешивать перед применением.
- Термопластичные клеи имеют не такую прочность, как термореактивные. Затвердение клея происходит при более низкой температуре. Некоторые могут затвердевать при комнатной температуре, что позволяет использовать их для сборки чувствительных компонентов. Клеи быстро размягчаются под действием повышенных температур.

• Эластомерные клеи - это подгруппа термопластичных клеев. Примером таких клеев может быть силиконовый клей. Способен затвердевать при комнатной температуре.

В процессе курсовой работы, будут рассмотрены 3 представителя термореактивных клеевых композиций, приведенных в таблице 12.

Таблица 12 – Сравнительная характеристика клеев[17,18,19]

Марка клея	CB-6590	JU-R2S	PD 955 M
Производитель	EICT	KOKI	Heraeus
Метод нанесения	дозирование	дозирование	дозирование
Рекомендуемые условия отверждения	3 минуты при 150°C	2 минуты при 170°C	3 минуты при 125°C
Цвет	красный	красный	красный

По результатам обзора клеевых композиций для монтажа компонентов, можно сказать, что, все клеи, представленные на рынке, имеют достаточно схожие характеристики. Я выбрал клей JU-R2S производителя КОКІ, так как, данный клей предназначен специально для дозированного метода нанесения, и применяется для использования с бессвинцовыми припойными пастами [18]. Клей поставляется в тюбиках, которые без проблем крепятся на полуавтоматический дозатор. Кроме того, клей не требует отчистки после монтажа, что позволит избежать дополнительной технологической операции. Клей имеет следующие преимущества:

- Стабильная форма наносимых клеевых капель;
- Отличная адгезия с корпусами;
- Допускает резкое увеличение температуры;
- Короткое время отверждения;
- Возможность нанесения дозатором;



Рисунок 17 – клей для монтажа компонентов на ПП JU-R2S производителя KOKI[18]

## 3.2.2 Выбор припойной пасты

Припойная паста — механическая смесь порошка припоя, связующего вещества, флюса и других компонентов. В настоящее время, широкое распространение получили бессвинцовые соединения, связано это, в первую очередь, с вредным воздействием на здоровье человека припоев, содержащих свинец. Существует большое количество паст, не содержащих свинца, отличие которых заключается в типе флюсового материала, температуре плавления, необходимости отчистки после оплавления и т.д. В настоящей курсовой работе будут рассмотрены два представителя класса бессвинцовых припойных паст, разных производителей: Cobar SAC4-325GM5 и Almit LFM-48U MDA-5.

Таблица 13 – Сравнительная характеристика бессвинцовых припойных паст[20]

Припойная паста	SAC4-325GM5	LFM-48U MDA-5
Производитель	Cobar	Almit
Тип сплава	бессвинцовый	бессвинцовый
Состав	Sn95,5Ag4Cu0,5	Sn96,5Ag3Cu0,5

Продолжение таблицы 13.

Точка плавления, °С	217	217 - 220
Размер частиц	тип 4	тип 5
Тип флюса	REL1	ROL1
Металл, % в весовом отношении	84,57	85
Время жизни после нанесения, час	< 12	< 12
Применение в дозаторах	Да	Да

Обязательным условием отбора была функция нанесения пасты пневмодозатором, который работает только с пастами размер шариков сплава которых не менее 4-го типа, что, по стандарту IPC J-STD-005, соответствует диаметру частиц припоя не более 38 мкм [21,22].

Важно отметить, что оба приведенных варианта припойных паст являются типом безотмывочных на основе синтетических флюсов. Это позволяет уменьшить количество технологических операций, исключив отмывку флюса после пайки.



# Рисунок 18 – паяльные пасты SAC4-325GM5 и LFM-48U MDA-5 производителей Cobar и Almit соответственно[23]

Таким образом, сравнив оба приведенных варианта, я выбрал припойную пасту LFM-48U MDA-5 производителя Almit, изображенную на рисунке 18. Она удовлетворяет всем заявленным требованиям, а также может быть нанесена с через полуавтоматический дозатор.

### 3.3 Нанесение припойной пасты

Учитывая все типы корпусов компонентов в ячейке, выберем способ нанесения припойной пасты. Производство является мелкосерийным, необходимо выбрать оптимальное оборудования, так, чтобы все установки справлялись с заданным объемом работ, но при этом не было простоя. Рассмотрим несколько способов нанесения припойной пасты:

- трафаретной печатью;
- дозированное нанесение;

Трафаретная печать — нанесение припойной пасты через «окна» в металлическом трафарете. Такой способ применяется при изготовлении большого объема ПП и является избыточным при мелкосерийном производстве, во многом это обусловлено тем фактором, что для каждой серии ПП требуется трафарет.

Дозирование припойной пасты – нанесение припойной пасты с применением дозирующего оборудования. Позволяет получать точное нанесение материалов. Существует три вида дозаторов – ручной, полуавтоматический и автоматический. Он может применяться не только для дозирования припойной пасты, но и для клея. Применение пневматической станции для дозирования позволяет добиться следующих преимуществ по сравнению с ручными дозаторами:

- равномерные дозы наносимого материала;
- возможно дозирование как припойной пасты, так и клея;

Принцип действия пневматического дозатора заключается в следующем: на жидкость, находящуюся в шприце воздействует пневмоимпульс, который выдавливает ее. Погрешности при нанесении материала минимальные, так как давление контролируется сжатым воздухом и таймером времени, управляемого процессором.

Рассмотри несколько дозаторов, разных производителей и разных конструкций.

Таблица 14 – Сравнительная характеристика пневматических дозаторов[25,26,27]

Модель	XDP-200D	CoatFlow GK1	ND-35
Производитель	Goot	INNOMELT	ТЕРМОПРО
Тип дозатора	пневматический	пневматический	пневматический
Способ дозирования	ручной, полу-авто	автоматический	ручной, полу-авто
Производительность	1000 доз/мин	3 500–5 000 доз/ч	1000 доз/мин
Тип производства	мелкосерийное	мелкосерийное	мелкосерийное

По результатам обзора различных дозаторов, можно сказать, что, не лишним было бы применение полностью автоматического дозатора производителя INNOMELT. Но, учитывая количество компонентов в ячейке, применение такого дозатора нецелесообразно. В данном случае необходимо применить полуавтоматический ручной дозатор, скорость дозирования которого, зависит только он человека, выполняющего монтаж. Помимо этого, дозатор будет использоваться не только для нанесения припойных паст, но и для нанесения



клеевой композиции при монтаже компонентов. Я остановлю свой выбор на дозаторе ND-35 отечественного производителя ТЕРМОПРО (рисунок 19).

Рисунок 19 – полуавтоматический дозатор ТЕРМОПРО ND-35[12]

## 3.4 Сборка и монтаж

Первым этапом при сборке является дозированное нанесение припойной пасты на КП платы. Делается это с применением превматического дозатора ND-35 производителя ТЕРМОПРО. На этом этапе необходимо точно подобрать дозу припойной пасты, во избежание избыточного или недостаточного количества пасты. Важно учесть, что ПП имеет разнообразные компоненты, размер выводов которых также различен, а, следовательно, необходимо четко знать сколько доз припойной пасты необходимо нанести на ту или иную КП. Так же на плате имеются стабилизаторы напряжения, которые имеют радиатор, крепление которого осуществляется к большим КП под корпусом, в этих местах важно равномерно нанести дозы припойной пасты по всей теплоотводящей площадке.

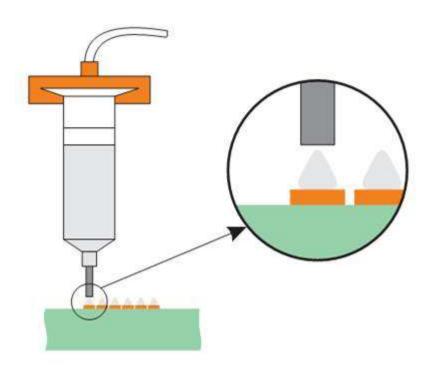


Рисунок 20 – процесс нанесение доз припойной пасты на КП платы[28]

После нанесения припойной пасты осуществляется процесс дозирования клеевой композиции (рисунок 20). Процесс осуществляется с применением все того же дозатора ND-35. Дозатор необходимо предварительно настроить, но так как дозатор имеет несколько режимов работы и способен запоминать установленные настройки. Переключение между процессами нанесения припойной пасты и клея

осуществляется только заменой тюбика наносимого материала и выбора программы дозирования.

При дозировании клея, как и при дозировании припойной пасты, важно четко знать, какое количество клея необходимо нанести на определенное место ПП. Нельзя допускать нанесения большого количества клея и его растекания, также, хоть выбранный клей JU-R2S и является термореактивным, нельзя допускать большого временного разрыва между операцией нанесения клеи и позиционированием компонента.

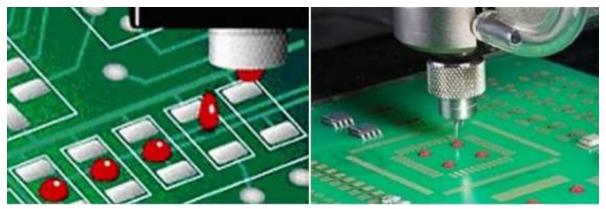


Рисунок 21 – процесс нанесение доз клея на посадочные места компонентов[29]

Следующим этапом сборки является процесс позиционирования компонентов, который осуществляется вручную - пинцетом. Особых требований к пинцетам нет, поэтому был выбран инструмент П-114 отечественного производителя Интермед (рисунок 22).



Рисунок 22 – пинцет П-114 производителя Интермед[30]

Позиционирование осуществляется согласно шелкографическому рисунку на плате (рис. 3), важно не только точно установить компонент по рисунку шелкографии, но и убедиться, что вывода ЭРК хорошо прилегают к КП платы и имеют хороший контакт с припойной пастой. Контроль качества сборки осуществляется визуально с помощью микроскопа Альтами LCD (рисунок 16). Данный микроскоп был выбран по причине совмещенности конструкции

стереомикроскопа и LCD монитора, что очень удобно при позиционировании компонентов на ПП. Микроскоп, в своем составе имеет столик, на котором было бы удобно одновременно совершать сборку и контролировать процесс. Также, данный микроскоп можно применить на этапах нанесения доз припойной пасты и клея, если требуется повышенная точность. Помимо этого, микроскоп применим для визуальной оценки качества монтажа компонентов, что в дальнейшем позволит, не прибегая к использования дополнительного оборудования, использовать его при оценке качества монтажа.



Рисунок 23 – микроскоп Альтами LCD[31]

Завершающим этапом процесса сборки является процесс отверждения клея. Так, как применяется термореативный клей, то, для его затвердевания необходимо приложить определенную температуру. Для выбранного клея оптимальным условием отвердевания является воздействие температуры 170°С в течении 2-х минут, что позволяет совершить процесс отвердевания клея без оплавления припоя. Максимальная температура воздействия на клей не должна превышать 250°С, что позволяет не допустить разрушения клеевой композиции на этапе монтажа, так как температура оплавления выбранной припойной пасты составляет 220°С.

Для данной операции необходим термовоздушный паяльный фен. Помимо операции отверждения клея, термовоздушный фен будет применим на этапе монтажа, поэтому при выборе оборудования, это необходимо учесть. Целесообразно выбрать полнофункциональную паяльную станцию, которая бы помимо паяльного фена, была оснащена контактным инструментом пайки, необходимым для устранения различных дефектов, таких как перемычки между КП или выводами ЭРК, непропаями и т.д.

Проанализировав рынок полнуфункциональных паяльных станция, я выбрал 3 представителя разных производителей, сравнительные характеристики которых приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Сравнительная характеристика полнофункциональных паяльных станций[32,33,34]

Модель	LUKEY-852D+	ELEMENT 702	ICV2000-AI
Производитель	LUKEY	ELEMENT	ERSA
Температурный диапазон, °С	200-480	200-480	50-550
Воздушный поток, л/мин	23	120	20
Потребляемая мощность, Вт	350	650	200
Габариты (ДхШхВ), мм	187x135x245	135x157x185	180x280x115
Цена, руб.	6300	7200	81650

По результатам обзора полнофункциональных паяльных станций, можно сказать, что станция ICV2000-AI не подходит, так как имеет сильно завышенную стоимость, которая не объясняется ее характеристиками. Станции LUKEY-852D+ и ELEMENT 702 расположены в одном ценовом диапазоне, но подробно изучив характеристики обоих, я выбрал паяльную станцию производителя ELEMENT модели 702 (рисунок 24). Помимо этого, ввиду личного опыта работы с паяльной станцией LUKEY-852D+, могу сказать, что расположение компрессора в корпусе паяльной станции не лучшее решение. Удобнее пользоваться паяльным феном, у которого и нагревательный элемент, и компрессор расположены непосредственно в ручке фена. Это дает некоторые преимущества при работе с бесконтактной пайкой, так как, резиновый шланг, по которому идет воздух от компрессора к соплу неудобен из-за своих массогабаритных показателей.

Выбранная паяльная станция оснащена электронной регулировкой и цифровой индикацией температуры, как фена, так и паяльника, что очень удобно при применении ее в различных технологических операциях, в нашем случае, для нагрева клеевой композиции и оплавления припойной пасты. Помимо этого, в данной станции регулируется скорость воздушного потока.



Рисунок 24 – термовоздушная паяльная станция ELEMENT 702[33]

Когда все компоненты собраны на печатной плате, можно перейти к их электрическому соединению. Так как предварительно была нанесена припойная паста на контактные площадки, количество операций монтажа сводится к минимуму. Завершающим этапом будет оплавление припойной пасты термовоздушным паяльным феном, выбранным ранее. Температура обработки составляет 220-230°С, время обработки зависит от нескольких факторов, таких как: скорость воздушного потока, удалении фена от поверхности ПП, площадь ПП, количества компонентов, типов корпусов компонентов, установленных на плату и т.д.

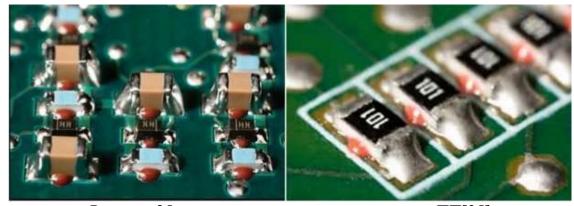


Рисунок 25 – смонтированные компоненты на ПП[35]

#### 3.5 Контроль качества

Контроль качества необходим для выявления дефектов, брака и оценки качества проведенной операции. Технологически КК делится на разрушающий и неразрушающий. Первый проводится только после выполнения какой-либо операции и не влияет на сам процесс. Его суть заключается главным образом в проверке по усилию отрыва, полученное значение сравнивается с нормированным значением. Неразрушающий контроль проводится как во время выполнения любой операции, так и после, при этом могут вноситься корректировки в сам процесс. К нему относятся следующие методы:

- Визуальный (с применением оптических средств контроля);
- Электрический (по измерению электрических параметров);
- Тепловые (по величине ИК-излучения с поверхности соединений);
- Рентгеновский.

Контроль позволяет определить:

- Наличие и форму галтелей;
- Короткие замыкания;
- Смещение выводов;
- Наличие пустот.

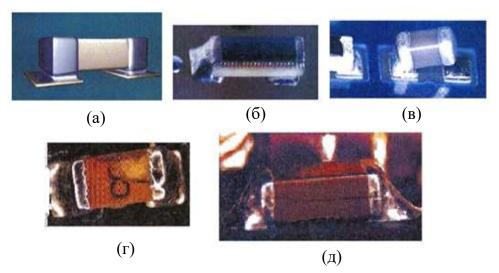


Рисунок 26 – дефекты сборки и монтажа чип-компонентов (малое количество припоя под (а), выступ торца под (б), эффект «надгробного камня» под (в), скол на корпусе компонента под (г) и трещина в корпусе компонента под (д))

В нашем случае необходимо осуществлять только неразрушающий вид КК. Будем пользоваться визуальным контролем и электрическим. Для визуального контроля будем использовать микроскоп Альтами LCD, выбранный ранее. Данный вид КК используется, как до, так и после технологической операции. Дефекты, которые возможно обнаружить визуальным методом представлены на рисунке 26.

Для электрического контроля качества будем применять универсальный цифровой мультиметр. Требование к мультиметру предъявляются следующие: наличие функций измерения сопротивления и емкости. Составим таблицу сравнительных характеристик нескольких универсальных мультиметров:

Таблица 16 – Сравнительная характеристика универсальных цифровых мультиметров[36,37,38]

Модель	UT107	M9508	M838
Производитель	Uni Trend	Mastech	Mastech
Диапазон измерения постоянного напряжения, В	1000	1000	600
Диапазоны измерения переменного напряжения, В	750	700	600
Диапазоны измерения постоянного тока, А	10	20	10
Диапазоны измерения переменного тока, А	нет	20	нет
Измерение сопротивления	да	да	да
Измерение емкости	нет	да	нет
Измерение частоты	да	да	нет
Измерение температуры	да	да	да
Размеры (ДхШхВ), мм	179x88x30	192x91x42	126x70x24
Цена, руб.	2200	2260	970

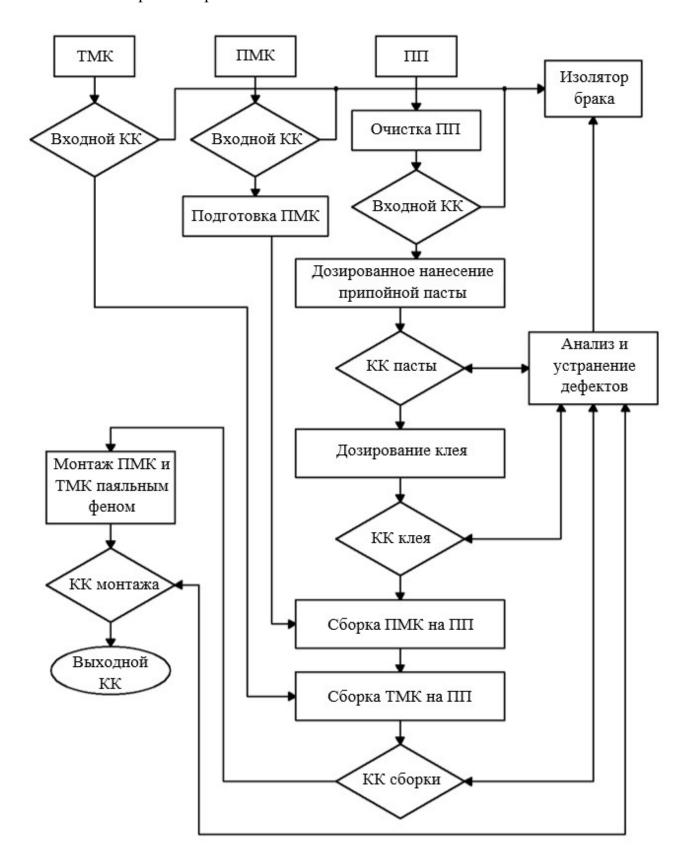
По результатам проведенного сравнительного анализа, я выбрал мультиметр M9508 производителя Mastech (рисунок 27). Данный прибор имеет функции измерения всевозможных величин, что не будет лишним, учитывая, что за аналогичную цену можно приобрести менее функциональный мультиметр.



Рисунок 27 – мультиметр универсальный цифровой Mastech M9508[38]

Электрический контроль качества осуществляется «прозвонкой» электрических цепей, а также изменением сопротивления и емкости дискретных смонтированных компонентов.

## 3.6 Алгоритм сборки и монтажа



#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была сконструирована система, позволяющая вычислить отклонение курса движения. В процессе разработки системы был разработан комплект сопутствующей документации. В следующем составе: конструкторская — ПЭЗ, СБ, ЭЗ, СП, ВП; технологическая — маршрутная и операционная карты.

При разработке устройства гиростабилизации была спроектирована схема электрическая принципиальная, выбраны электрические компоненты и построена топология печатной платы. В процессе выполнения ВКР были проведены расчеты модуля гиростабилизатора на надежность, отказоустойчивость и стойкость к воздействиям механических нагрузок. По результатам расчетов можно сделать вывод, о том, что устройство соответствует требованиям технического задания. При разработке системы вычисления отклонения от заданного курса был проведен сравнительный анализ устройств, удовлетворяющих техническому заданию, для реализации клиент-серверной системы обмена данными. Также, было разработано программное обеспечение, как для серверного, так и для клиентского устройства. Был спроектирован и реализован пользовательский интерфейс клиентского приложения.

В процессе выполнения ВКР был составлен технологический маршрут изготовления устройства гиростабилизации. Также, были подобраны оптимальные материалы и установки для его реализации. Была составлена операционная карта технологического процесса.

#### СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- МЭМС гироскопы // URL: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=134058 (дата обращения 12.05.2018);
- 2. Гирокомпас PGM-C-010 // URL: http://cirspb.ru/equipment-and-service/gyro/pgm-c-010/ (lfnf j,hfotybz 05.05.2018);
- 3. Гирокомпас Teledyne Meridian // URL: http://cirspb.ru/equipment-and-service/gyro/teledyne-meridian/ (дата обращения 05.05.2018);
- 4. Гирокомпас Tokyo Keiki TG-8500 URL: http://cirspb.ru/equipment-and-service/gyro/tg-8500/ (дата обращения 05.05.2018);
- 5. Гирокомпас PGM-CRG-022 URL: http://cirspb.ru/equipment-and-service/gyro/girokompas\_pgm\_crg\_022/ (дата обращения 05.05.2018);
- 6. Микроконтроллер ATmega8-16AU URL: https://www.chipdip.ru/product/atmega8-16pu (дата обращения 21.11.2017);
- 7. Микроконтроллер STM32F030K6T6 URL: https://www.chipdip.ru/product/stm32f030k6t6-2 (дата обращения 21.11.2017);
- 8. ЖКИ Winstar WH1604A-YGH-CT URL: https://www.chipdip.ru/product/wh1604a-ygh-ct (дата обращения 21.11.2017);
- 9. Схема прошивки МК URL: http://easyelectronics.ru/ (дата обращения 22.11.2017);
- 10. ДУС МГ-10 URL: http://www.mp-lab.ru/ (дата обращения 22.11.2017)
- 11. Заводян А.В., Волков В.А. Производство перспективных ЭВС: Учебное пособие. Ч.2. М.: МИЭТ, 1999. 280с.;
- 12. Шитов Д. И. Конспект лекций по курсу «Основы конструирования электронных средств» 2017;
- 13. Raspberry PI URL: https://habr.com/post/247337/ (дата обращения 15.05.2018);
- 14. Beaglebone-black URL: https://www.chipdip.ru/product/beaglebone-black-rev-c (дата обращения 15.05.2018);
- 15. Odroid-C1+ URL: https://ur7hbq.blogspot.ru/2015/02/odroid-c1.html (дата обращения 15.05.2018);
- 16. Изображения различных электронных компонентов // URL: https://www.chipdip.ru/. (дата обращения: 10.12.2017);

- 17. Клей MATT CB-6590 // URL: https://smttech.ru/card/CB-6590. (дата обращения: 10.12.2017);
- 18. Клей KOKI JU-R2S // URL: http://www.mettatron.ru/produktsiya/payalnye-materi aly/klei-dlya- poverkhnostnogo-montazha/klej-koki-ju-r2s. (дата обращения: 10.12.2017);
- 19. Клей Heraeus PD 955M // URL: https://olimpel.ru/catalog/materials/klei\_smd/PD955M/. (дата обращения: 10.12.2017);
- 20. Припойные пасты, сравнительные характеристики // URL: https://www.dipaul.ru/u pload/iblock/9ed/02\_01\_dipaul\_smt\_oborudovanie\_dlia\_sborki\_elektroniki.pdf. (дата обращения: 10.12.2017);
- 21. Размер частиц припоя // URL: http://opiobjektid.tptlive.ee/Jootmine(vene)/\_ 28.html. (дата обращения: 10.12.2017);
- 22. Стандарт IPC // URL: http://pcbdesigner.ru/downloads/IPC\_rus/IPC\_ECA%20J-STD-002C.pdf. (дата обращения: 10.12.2017);
- 23. Припойные пасты Cobar и Almit // URL: http://dialural.ru/payalnyye-pasty-balver-zinn-cobar-dlya-dozirovaniya-i-trafaretnogo-naneseniya. (дата обращения: 10.12.2017);
- 24. Припойные пасты // URL: http://www.smtexpert.org/materials-for-electronics/solde ring-materials/solder-paste/cEN770-default.aspx. (дата обращения: 10.12.2017);
- 25. Автомат дозирования GK-1 // URL: http://www.assemrus.ru/oborudovanie/sborochn o-montazhnoe-oborudovanie/avtomaty-dozirovaniya/coatflow-cf395blanco. (дата обращения: 10.12.2017);
- 26. Цифровой дозатор XDP-200D // URL: https://sovtest-ate.com/equipment/xdp\_200d/. (дата обращения: 10.12.2017);
- 27. Дозатор ND-35 // URL: http://termopro.ru/catalog/dozatory\_payalnoj\_pasty\_i\_zhidko/dozatory\_zhidkostej\_nd-35\_55/. (дата обращения: 10.12.2017);
- 28. Методы нанесения припойных паст // URL: http://opiobjektid.tptlive.ee/Joot mine(vene)/\_\_12.html. (дата обращения: 10.12.2017);

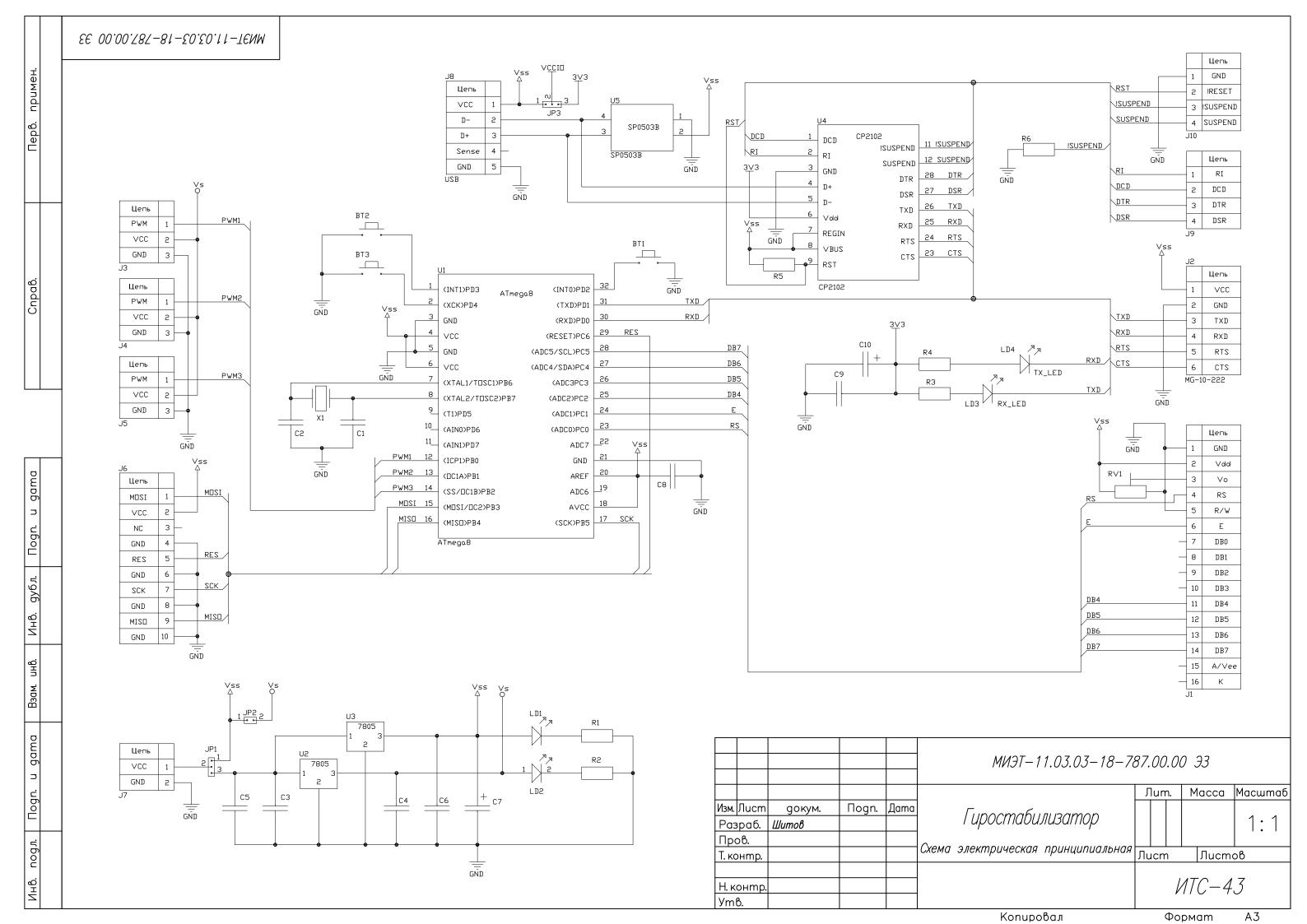
- 29. Нанесение припойной пасты // URL: http://opiobjektid.tptlive.ee/Jootmine(vene)/ \_\_12.html. (дата обращения: 10.12.2017);
- 30. Пинцет гнутый П-114 // URL: https://www.chipdip.ru/product/p-114. (дата обращения: 10.12.2017);
- 31. МикроскопАльтамиLCD//URL:http://altami.ru/microscopes/stereo/digi/altami\_ lcd/#gallery. (дата обращения:10.12.2017);
- 32. Станция паяльная термовоздушная LUKEY-852D+ // URL: https://www.chipdip.ru/product/lukey-852d-plus. (дата обращения: 10.12.2017);
- 33. Паяльная станция ELEMENT 702 // URL: https://www.chipdip.ru/product/element-702. (дата обращения: 10.12.2017);
- 34. Станция паяльно-ремонтная ICV2000-AI // URL: https://www.chipdip.ru/product/icv2000-ai. (дата обращения: 10.12.2017);
- 35. Смонтированные компоненты на плате (картинка) // URL: https://smttech.ru/card/CB-6520P. (дата обращения: 10.12.2017);
- 36. Мультиметр цифровой UT107 // URL: https://www.chipdip.ru/product/ut107. (дата обращения: 10.12.2017);
- 37. Мультиметр цифровой M838 // URL: https://www.chipdip.ru/product/m838. (дата обращения: 10.12.2017);
- 38. Мультиметр цифровой M9508 // URL: https://www.chipdip.ru/product/m9508. (дата обращения: 10.12.2017);

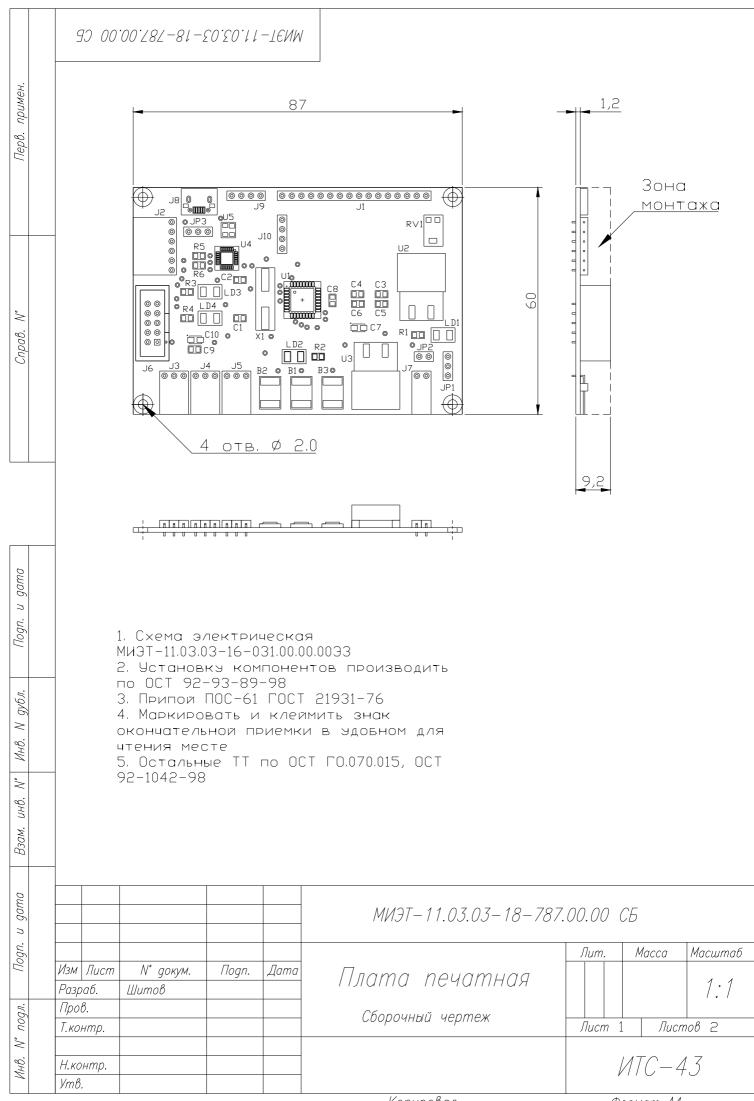


ЭН.	Формат	Лоз.	Обозначение	Наименование Документация	Кол.	Приме— чание
Перв. примен.	<i>A4</i>		MU9T-11.03.03-18-787.00.00 C5	Сборочный чертеж		
	A3		MU3T-11.03.03-18-787.00.00 33	Схема электрическая		
				принципиальная		
Справ. №	<i>A4</i>		МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ПЗ	Пояснительная записка		
Cny	<i>A4</i>		МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00 ПЭ.	В Перечень элементов		
	-A3		МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ВП	Ведомость покупных		
				изделий		
u gama			МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 Д1	3-D модель платы		
Подп. ц				Сборочные единицы		
" дубл.		1	МИЭТ-11.03.03-18-787.00.00 ГГЭ.		1	
N° MHB. N°				Прочие изделия		
инв.		2		Датчик угловой скорости	1	
Взам.				MF-10-111-P		
u gama						
Подп.	Изм ,	Пист	N° докум. Подпись Дата	МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00	1	
N° nogn.	Разра Пров.	ю.	Шитов	табилизатор лит. Табилизатор	Лист 1	Листов 3
Инв.	Н.кон Утве <sub>г</sub>			<u> </u>	/ ( '-	- 43

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
				Микроконтроллер		
		3		ATmega8-16AU	1	U1
				Микросхема		
		4		CP2102-GMR	1	U4
				Кварцевый резонатор		
		5		HC-49SM 16.000 MFu	1	X1
				Сборка защитных диодов		
		6		SP0503BAHTG	1	U5
				Стабилизаторы напряжения		
		7		L7805ABD2T-TR 5B	2	U2,U
				Светодиоды		
		9		FM-P3528WDS-460QL-R70	4	LD1L
				Кварцевый резонатор		
		13		HC-49SM 16.000 MFų	1	X1
				Сборка защитных диодов		
		14		SP0503BAHTG	1	U5
				Резисторы		
		15		RC0805FK-07200RL	4	R1R
		19		RC0805FK-0710KL	1	R5
		20		RC0805FK-074R7L	1	R6
		21		3314G-1-103E	1	RV1
				Конденсаторы		
		22		MLCC22pFNP050V5%0805	2	C1, C2
				МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00		Ли

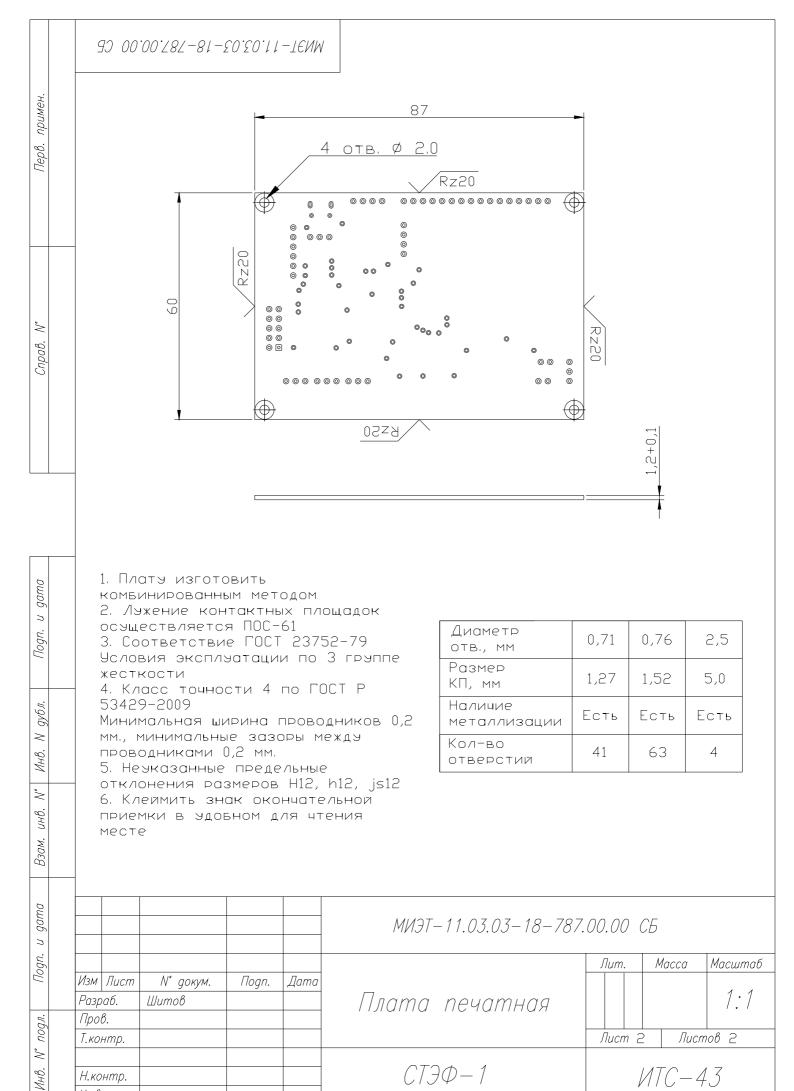
Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме чание
		24		Кер. ЧИП 0, 1мкФ X7R, 10%, 1206	3	C3,C8,C
		27		Кер. ЧИП 0,33мкФ 20% X7R 0805	2	C4,C6
		29		TECAP 0,47ΜκΦ20%35B TunA	1	C7
		30		Кер. ЧИП 4,7мкФ X5R 10% 0805	1	C10
				Переключатели		
		31		Кнопка тактовая FSM1LP	3	BT1B
		34		PLS-3 (DS1021) 1x3 mun 1	1	JP1
		35		PLS-2 (DS1021) 1x2 mun 1	1	JP2
				Вилки штыревые		
		36		PLS—16 (DS1021) 1x16 прямая	1	J1
		37		PLS—6 (DS1021) 1x6 прямая	1	J2
		38		PLS—3 (DS1022) 1x3 угловая	3	J3J.
		41		PLS—2 (DS1021) 1x2 прямая	1	J7
		42		PLS—4 (DS1021) 1х4 прямая	2	J9,J1
				Разьемы		
		44		BH-10 (DS1013-10S)	1	J6
		45		Разьем micro USB—B	1	J8
				Цифровые сервоприводы		
		46		Futaba S3156	3	
-		70				
				МИЭТ—11.03.03—18—787.00.00		Лис
Изм	Ли	cm N°	докум. Подпись Дата			





Копировал

Формат А4



Копировал

Утв.

Формат А4

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	Стабилизаторы		
<i>U2,U3</i>	Стабилизатор напряжения L7805ABD2T—TR 5B	2	Kopnyc d2pac
	1,5A 2% ST Microelectronics		
	<u>Защитные диоды</u>		
U5	SP0503BAHTG 5B Littelfuse	1	Kopnyc to-253-4
	<u>Переключатели</u>		
BT1BT3	Кнопка тактовая FSM1LP TE Connectivity (Тусо)	3	
JP1	PLS—3 (DS1021) 2.54мм 1x3 прямая тип 1	1	
JP2	PLS—2 (DS1021) 2.54мм 1х2 прямая тип 1	1	
	Вилки штыревые		
J1	PLS—16 (DS1021) 2.54мм 1x16 прямая тип 1	1	
J2	PLS—6 (DS1022) 2.54мм 1x6 угловая тип D1	1	
J3J5	PLS—3 (DS1022) 2.54мм 1х3 угловая тип D1	3	
J7	PLS—2 (DS1021) 2.54мм 1х2 прямая тип 1	1	
J9,J10	PLS—4 (DS1021) 2.54мм 1х4 прямая тип 1	2	
	<u>Разьемы</u>		
J6	BH-10 (DS1013-10S) 2.54мм 2x10 Zhenqin	1	
J8	Разьем micro USB-B 47346-0001 угловой Molex	1	
		<u> </u>	Писп
Изм Лист	N' докум. Подпись Дата	00.00	1133

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

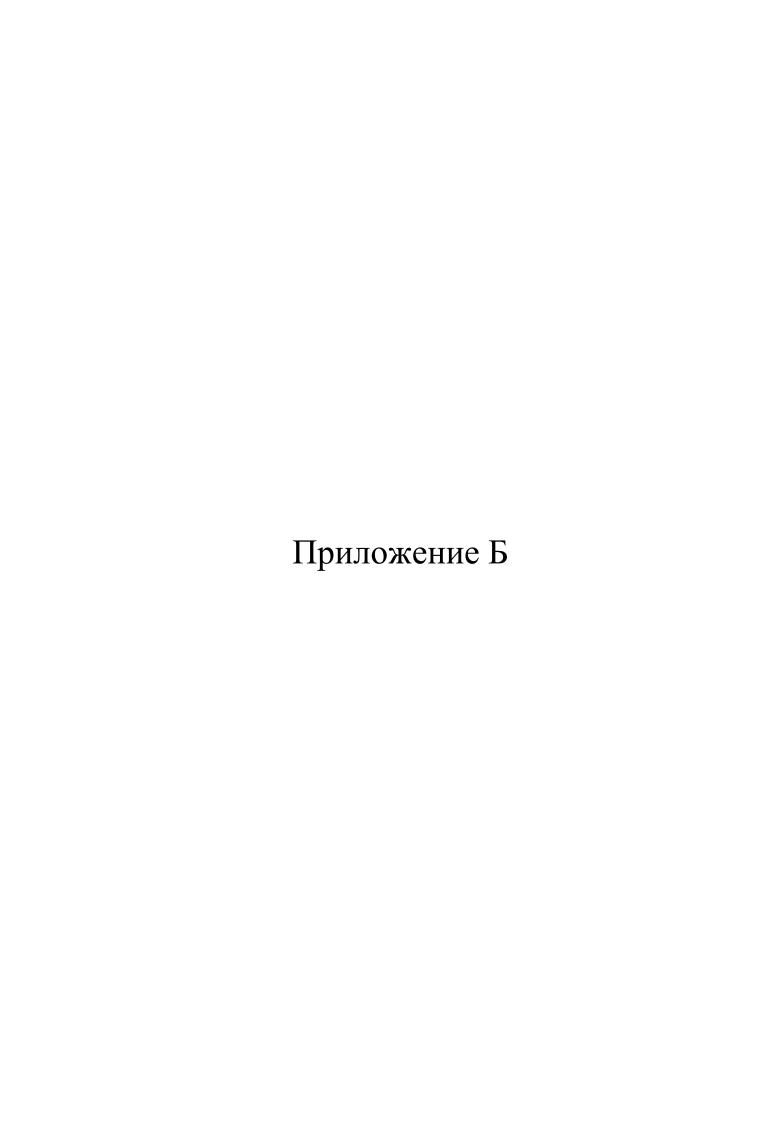
	Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
H.				
примен.		<u> Микросхемы</u>		
Перв. 1	U1	Микросхема ATmega8—16AU Atmel	1	Kopnyc TQFP-32
	U4	Микросхема CP2102-GMR Silicon Laboratories	1	Kopnyc QFN-28
		<u>Конденсаторы</u>		
	C1,C2	$K$ онденсатор кер. ЧИП 22n $\Phi$ $\pm 5\%$ 50B 0805	2	Китай
	C3, C8, C9	Конденсатор кер. ЧИП 0,1мкФ $\pm 10\%$ 100В 1206		Китай
<b>`</b>	C4,C6	Конденсатор кер. ЧИП 0,33мк $\Phi$ $\pm 20\%$ 50В 0805	2	Китай
Справ.	C7	Конденсатор TECAP 0,47мкФ 20% 35B Tun A		Китай
	C10	Конденсатор кер. ЧИП 4,7мкФ 10% 25B 0805 X5R	1	Murata Manufact.
	D1 D1	<u>Резисторы</u>		
	R1R4	Резистор ЧИП 200 Ом 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	4	
	R5	Резистор ЧИП 10кОм 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	1	
	R6	Резистор ЧИП 4,7кОм 1% 0,125Вт 0805 Тайвань	1	
gama	RV1	Резистор подстроечный SMD 10кОм 20% 0,25Вт 3314G-1-103E Boums		
7		JJ146-1-10JL   D0UIIIS		
Nogn.		Chomoguagu		
		CBemoguogus  FM D3538WDS 46001 P70 NationStar		
" дубл.	LU1LU4	FM-P3528WDS-460QL-R70 NationStar	4	
Инв. №		<u>Резонаторы кварцевые</u>		
<u>`</u>	X1	Резонатор кварцевый 16.000 МГц HC—49SM	1	Китай
инв.				
Взам.				
00				
u gama				
Подп.	<i>u</i> 5	MU3T-11.03.03-18-78	7.00	1.00 ПЭЗ
3л.	Изм Лист Разраб. Ц	N° докум. Подпись Дата Шитов	Ли	ит. Лист Листов
№ подл.	Пров.	Гиростабилизатор		1 2
Инв. ∧	Н.контр.	Перечень элементов		<i>MTC-43</i>
	Утвердил	Перечень элементой		Danuar 11

Копировал

Формат А4

	DXC			Обозначение			V Q		Колич	ество	Приме-
Ï	Строка	Наименование	Код продукции	документа на поставку	Поставщик		Куда в (обозна	ходит чение)	на из— в ком— делие плекты		чание
примен	1	Микросхемы									
Перв.	2	ATmega8-16AU			Atmel				1	1	TQFP-32
	3	CP2102-GMR			Silicon Laboratories				1	1	QFN-28
	4	L7805ABD2T-TR			ST Microelectronics				2	2	d2pak
	5	SP0503BAHTG			Littelfuse				1	1	to-253
	6										
Cnpaß.	7	Датчик угловой скорости									
Cnp	8	MF-10-111-P	ЛМАП.402131.011ЭТ		000 «ЛМП»				1	1	
	9										
	10	Кварцевые резонаторы									
	11	HC-49SM 16.000 MFų			Китай				1	1	
	12										
2	13	Резисторы									
u gar	14	RC0805FK-07200RL			Китай				4	4	
∏ogn	15	RC0805FK-0710KL			Китай				1	1	
	16	RC0805FK-074R7L			Китай				1	1	
дубл.	17	3314G-1-103E			Boums				1	1	
Z E Ö,	18										
uHB.	19	Конденсаторы									
Взам.	20	Kep. 4ИΠ 22nΦ ±5% 50B 0805			Китай				2	2	
Инв. подл. Подп. и дата					Раз Про	Лист докум. граб. <i>Шитов</i> ъв.	Подп. Дата	Гиростав	-11.03.03—18—7 Э́ИЛИЗАМОР	787.00.00 ВП Пит. Лис. 1 ИТС-	2

)KQ		значение		Kuga Byog	um	Количество		Приме-
Строка	Наименование	мента на оставку	Поставщик	Куда входи (обозначен	)	на из- в ком- на ре- делие плекты гулир.	всего	чание
1 <i>f</i>	Кер. ЧИП 0, 1мкФ ±10% 100В 1206	K	umaŭ			3	3	
2 k	Кер. ЧИП 0,33мкФ ±20% 0805	K	umaŭ			2	2	
3 7	TECAP 0,47мкФ 20% 35B Tun A	K	umaŭ			1	1	
4 1	Кер. ЧИП 4, 7мкФ ±10% 25В 0805	M	urata Manufact.			1	1	
5								
6 (	Светодиоды							
7 /	FM-P3528WDS-460QL-R70	M	ationStar			4	4	
8								
9 1	Вилки штыревые							
10 F	PLS—16 (DS1021) 1x16 прямая	\ \	lingbo connfly electronic			1	1	
11 H	PLS—6 (DS1022) 1x6 угловая	Λ	lingbo connfly electronic			1	1	
12 1	PLS—3 (DS1022) 1x3 угловая	Λ	lingbo connfly electronic			3	3	
13 /	PLS—2 (DS1021) 1x2 прямая	$\wedge$	lingbo connfly electronic			1	1	
14	PLS-4 (DS1021) 1x4 прямая	\ \	lingbo connfly electronic			2	2	
15								
16	Разъемы							
17	BH-10 (DS1013-10S) 2x10	Z	hengin			1	1	
18	Разьем micro USB-B	M	lolex			1	1	
19								
20	Цифровые сервоприводы							
21	Futaba S3156	F	- utaba			3	3	
22								
23								
24								
25								
					1440 T 11 T	07.40.707.00	7	Лист
			Изм. Лист доку	м. Подп. Дата	MU3T-11.03.	03-18-787.00.00 BF		2



		_				1		О	CT 11.	.040.019-83	Рорма 4			
													12	
														1
											МИЭ	T.11.03.0	3.18.787	7.(
								<u> </u>		<u> </u>				
						77.6		1						
	+	_	<u>В</u> Г	Цех	Уч.	PM	Опер Обозн	 ачение доку		наименование о	перации			
		H	Д					нование обо		ания				
			T				наименовани							
		_	Л/М			Наиме				и материала				
		$\vdash$	0		I		l	ие операции						_
			B 01			<u> </u>	030	1		монтаж ко				_
+		_	02	на пе	чатную	плату і	модуля п	рограмм	ирує	емой гирос	габили	заци	И	_
		_	03			<u> </u>	I							_
			Д 04				й дозато	p'ND-35						
			Д 05	_ ^	оскоп А									
			Д 06		_		ьная ста		EME	ENT 702				
-		_	Д 07	Стол	монтаж	ника Р	9A APM	-4110						
			Д 08	Унив	ерсальн	ый циф	ровой м	ультиме	гр М	9508				
			09				<u> </u>							
ŀ		+	T 10	Пинц	ет Инте	рмед Г	I-114							
			T 11	Брасл	тет анти	статич	еский ЈТ	-97-081						
			T 12	Tapa	 техноло	гическ	ая ДМВ	M8.870.0	001					
L			T 13	Боко	резы ТС	PEX 3	2D106							_
			T 14		Ī		і ый элект	ротехни	ческ	 ий.				
			15			1								_
			Л 16	Спира	⊤ Г этилов	_ ый рек	тификов	анный те	ехни	ческий «Эн	стра»	ΓΟΟ	Т	_
			17		78-2013									_
		_	Л 18				т ажные, са	алфетки	(400	х400) мм, (	200x20	00) м	м	_
		-	19		Γ 29298-	1			(	11 100) 11111, (		00) 1.1		
		╬	Л 20		т атки кап		TA TA	T						_
			21	ПСРЧ		ропоы								_
		F	22		I		I							
		╁	23		T		Ι	1						_
		H	24		T		Ι							_
			27	<u> </u>				ı						
		$\perp$						Разработа.	Л	Шитов Д.И.				
								Проверил Утвердил		Виноградов	А.И.			_
_		Э Д						Н. Контр						_
		πĖ						Отв. АЦП	У					_

				ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
					2
				ТЕИМ	C.11.03.03.18.787.00
			T	Код, наименование операции	
		-	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала	
			О	Содержание операции (перехода)	Т
				1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
				1.1 К выполнению данной операции допускаются ли	ица:
Н				- не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмот	p,
				- изучившие техническое описание и инструкци	ию по
				эксплуатации установки;	
Щ				- прошедшие инструктаж и аттестованны	е на
					авилам
				эксплуатации электроустановок потребителей» и «Пра	
-				техники безопасности при эксплуатации электроустановок	
				- прошедшие инструктаж на рабочем месте с подпи	
				журнале инструктажа.	ilebio b
					онжом
				возникновение следующих видов опасности:	МОЖНО
				-электроопасность;	
-				-травмирование рук колюще-режущие предмета	ами и
Į				компонентами;	
				- пожароопасность;	
				- напряжение зрения.	
				•	орпуса
				установок, которые могут оказаться под напряжением в	-
				какой-либо неисправности (нарушение целостности зазем	
				или неисправной изоляции соединительных проводов и каб	5елей).
				1.4 Травмирование рук может возникнуть при каки	х-либо
				манипуляциях руками в рабочей зоне при выполнении р	абот с
				пинцетом, а также бокорезами.	
				1.5 Источником пожароопасности является эти	иловый
				спирт при наличии открытого огня или искры, термовозд	цушная
				паяльная станция, а также возможное воспламенение уста	ановок
				при их неисправности.	
Ду	В	П			
У Б	3 A	ОД			
Л		Л			
Ш		_			

						OCT 11.0	040.019-	83	Рорма 46	5	
											3
			1						МИ	ЭТ.11.03.03.18.	787.00 OK
	T			Код, наим	иенование (	операци	И				
	Л/М		Наи	менование детал							
	O			Содерж	кание опера	ации (пе	ерехода)	)			То
		1	.6 Источн	иком напр	яжения	зрен	ия яв	ляет	ся дли	ительная	
		работа с	с микроско	пом.							
		1	.7 Для об	еспечения	электро	безог	асно	сти г	геред	началом	
		работы	проверить	визуально	налич	ие и	целос	тнос	ть заз	емления	
		корпусс	в установ	ок пневмод	дозатор	аиу	нивер	саль	ной п	аяльной	
		станции	і, надежн	ость изоля	яции с	оедин	ителі	ьных	проі	водов и	
		кабелей	. Соблюда	ть требова	ания, и	зложе	нные	ви	нстру	кции по	
		эксплуа	тации этих	х установок	ζ.						
		C	облюдать	требовани	ия, изл	ожені	ные	в ин	нструк	сции по	
		«Охране	е труда при	и работе на	электро	оуста	новка	X».			
				бежание т							
				олнение ка							
		при про	оведении у	установкой	автома	атиче	ских	ЦИКЈ	іов. Е	3 случае	
		возникн		пасности	следуе	ет н	емедл	тенно	O OT	ключить	
		оборудо									
				ежание по							
		-		закрытом				над	пись	"спирт",	
			•	ельных при	•						
				бежание по			_			_	
				ез каждый	час ра	аооты	і дела	ать г	IMTTMI	инутныи	
		перерын		- E				- <u>~</u>	_		
			_	обнаружен		_		геи	в ус	становке	
		раооты	не произво	одить, вызв	ать нал	адчик	d.				
H 5 =											
Д В П У 3 О											
Б А Д —											
ЛМЛ											
	ОКУ		Опера	ционная карта у	/ниверсаль	ная					

					1			OCT 11.	040.019-	83	Рорма 46	5	
											МИ	ЭT.11.03.03.18.′	787.00
		_	T				именовани						
		_	Л/M О		На	пименование дет	али, сб.еди жание опе						
				2.	$OD\Gamma \Lambda 1$	деления ВИДАЕИН					TC A		
						тизация эке и монта						ю пноту	
					-		·				•	·	
				-	_	диомонтаж перации и и		_			теста		
						перации и и	імеющи	те квал	іифик	ацик	не ні	иже 4-10	
				разряда		ocarar v	у о от то	T 0 T1141			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T011110	
					-	абочем м						данная	
				_		арта, сборо		_					
					•	становки и		румен	г, а	такж	ce pa	сходные	
				_		итная экипі	-						
					.3 Электр		гигиена		•	/част		должна	
						гребования	•	аметра	ами ми	икроі	клима	га:	
						oa - (21,5±0							
						- (45±10)%							
						оты - 100, 1							
						ологическая		да пер	сонал	а уч	астка	должна	
Į						гребования						_	
						ологическое		орудов	вание	до	ОНЖПО	быть	
						но требова						_	
				2.		виды ремо		_	-		ческих	к работ	
				проводи			записьн	o pe	зульта	тов	В	журнале	
	-					рудования							
					.5 Перечо	•	филакт			рабо		и их	
				_	_	становлень	ы в экс	плуата	ацион	ной	докум	ентации	
				на устан	•								
					-	оль прив			-	ності	и ус	тановки	
				_	-	ор в следую	ощих сл	учаях	•				
				-	1 раз в не	делю;							
					-	ионта и про	_	-					
				- 1	повышен	ная дефекті	ность, п	ю указ	ванию	техн	олога	•	
Д У	B 3	П		<u> </u>				<u> </u>					
Б	A	Д -											
Л	M	Л											

т							(	OCT 11	040 019-9	3	ма 4б		
Т Кол, павыспование операции  Т Кол, павыспование операции  Т Кол, павыспование на материалыя  О Созержащие операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакстах раздельно.  2.8 Радиоэлсктронные компоненты хранить и транепортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.											-23 10		_
Т Код. наименование операции  ЛМ Наименование детали, сб.единацы или материала  О Солержание операции (переходы)  Те 2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика.  Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.	-												5
П.М   Павменование детали, сб. единицы или материала											МИЭ	T.11.03.03.18	.787.00 O
Содержание операции (перехода)      Сл. Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.      Капроновые перчатки надевать вне участка. Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.      Сл. В Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.      Сл. В Случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		T				Код, наг	 именование (	операци	и				
2.7 Работу по выполнению данной операции проводить в капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.					Наим					ала			
капроновых перчатках.  Капроновые перчатки надевать вне участка.  Хлопчатобумажные салфетки и перчатки хранить на участке в полиэтиленовых пакетах раздельно.  2.8 Радиоэлектронные компоненты хранить и транспортировать в закрытой технологической таре.  2.9 В случае возникновения на участке внештатной ситуации (пожара, отключение электроэнергии, изменение параметров микроклимата и т.д.) оператору необходимо немедленно доложить начальнику участка и вызвать наладчика. Дальнейшие его действия должны соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих инструкциях по охране труда и пожарной безопасности.		0											
	У 3 О		Хлог поли тране ситуа пара неме Даль излог	оновы Капр пчатоб вэтилен 2.8 спорти 2.9 ации метрон едленн ынейши	их перчатовоновые бумажны новых па Радиоэл ировать пожар в микро доложие его доложие его доложие в соо	перчамен салфет акетах развектронны в закрыто ае возни а, отклююклимата сить началействия д	атки ки и пер вдельно. е ко й технол икновени очение и т. пьнику у	наден рчатко мпон погиче ия на элект д.) ( участи	вать и хран еенты а уча проэне операт ка и в	вне нить на хра таре. стке прии, тору пызвать тр	уа уч анит внеп изм необ нал	участка. астке в ть и птатной менение ходимо адчика. ваниям,	
	БАД		+										
	JI MI JI												

							OCT 11.	040.019-83	3 Форма	4б	
									M	ИЭТ.11.03.03.18.7	787.00
		T				аименовани					
	-	Л/M О			Наименование д	етали, сб.еди сержание опе			ла		-
				3. Г	ІОДГОТОЕ				TA		
					готовка раб						
					едиться, чт					я станция	
			выключ	ены.							
			3	.1.2 Про	верить в	изуально	нал	ичие	и це.	лостность	
			заземле	ния авт	оматическо	го превм	иодоза	тора и	термов	оздушной	
			паяльно								
-	+			.1.3 Вкл		•	верит	ь ра	аботосп	особность	
				_	а и паяльно						
					ключить об					ісь о его	
					урнале готс						
					тотовка раб						
_					диться по						
					борудовани 						
				-	и проверена утствии заг					_	
				-	утствии заг работе не г						
					граооте не г гучить у те	•				,	
					ласно данн						
			_		<b>ГОТОВИТЬ</b>	_	держа	_	рабочее	место,	
					· компонентн			•		1	
				ŕ			1		1		
i [											
	В П 3 О										
у Б	В П 3 О А Д М Л										

Т Код, наименование операции  Т Наименование детали, еб единиция вих материала  О Содержание операции (перехода)  4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  4.1 Подучить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхность печатной платы.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В завнеимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.							C	OCT 11.	040.019-	83 <b>4</b>	Рорма 4	Ю.	
т Код. пальенование операции  ПМ Наименование детали, сб сдиницы или материалы О Содержание операции (перехода)  4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС  4.1 Подучоть рабочее место для монтажа компонентов.  4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3.1 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слетка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.													
											ΜI	ĬЭТ.11.03.03	3.18.787.0
Солержание операции (перехода)      4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС     4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в еледующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		T			К	од, наиме	нование о	пераці	и				
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС     4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3.1 Произвести очистку заготовки печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.		Л/М		]	Наименован	ие детали	, сб.един	ицы ил	и матери	ала			
4.1 Подготовить рабочее место для монтажа компонентов.     4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; крутовыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку пітыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.	-	О											
4.1.1 Получить кассеты с компонентами и заготовку печатной платы у технолога.     4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	. TEXH	ОЛОГИ	ЧЕСК	ИЙ ПР	ОЦЕ	CC				
печатной платы у технолога.  4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.1 Подг	отовить	рабоче	е мест	о для	н монт	ажа 1	комп	оненто	В.
4.1.2 Проверить по сопроводительному листу количество и соответствие электронных компонентов.     4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	1 Получ	ить ка	ссеты	с ко	мпоне	нтам	ииз	ваготові	ку
количество и соответствие электронных компонентов.  4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы у	техно.	пога.						
4.1.3 Проверить наличие прочих очищающих и технологических материалов.     4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	2 Прове	рить	ПО	сопр	оводи	итель	ному	и лис	гу
технологических материалов.  4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	оличесті	во и соот	гветств	ие эле	ктро	нных	комп	онен	тов.	
4.1.4 Монтажнику надеть антистатический браслет и капроновые перчатки.     4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	3 Прове	рить	налич	ие і	трочи	X Ou	ища	ющих	и
капроновые перчатки.  4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			T	ехнологі	ических	матери	алов.						
4.2 Визуально проверить целостность электронных компонентов.     4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.1.	4 Монта	ажнику	и надет	гь ан	гистат	ичес	кий (	браслет	И
компонентов.  4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.  4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			К	апронов	ые перча	атки.							
4.3 Произвести очистку заготовки печатной платы.     4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.     4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.2 Визуа	ально	провеј	оить	цело	остнос	сть	элен	строннь	JIX
4.3.1 Произвести очистку печатной платы в следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.      4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.      4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.      4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.      4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.      4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			компон	ентов.									
следующем порядке: слегка пропитать хлопчатобумажную бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.3 Прои	звести о	чистку	загот	овки	печат	ной г	ілать	I.	
бязь этиловым спиртом; круговыми движениями протереть поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.3.	1 Произ	вести	очио	стку	печа	атной	я́ п	латы	В
поверхность печатной платы пропитанной тканью; протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			c.	ледующ	ем поряд	дке: сл	егка п	ропи	гать х	лопч	атобу	умажну	то
протереть чистой хлопчатобумажной бязью поверхность печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			б	язь этил	овым сп	иртом;	круго	вымі	и двих	кения	ими п	ротере	ГЬ
печатной платы.  4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	оверхно	сть пе	чатной	пла	ты	проп	итані	ной	тканы	o;
4.4 Визуально проверить целостность заготовки печатной платы.     4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.     4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.     4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.     4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ротереті	ь чистой	і́ хлоп	чатобу	/маж	ной б	маєк	ПОВ	ерхнос	ТЬ
платы.  4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			П	ечатной	платы.								
4.5 Приступить к операции подготовки поверхностно монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.4 Визуа	ально пр	овери	гь цел	остно	ость за	агото	вки	печатно	ой
монтируемых компонентов.  4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			платы.										
4.5.1 Разделить планку штыревых вилок PLS на части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			4	.5 Прис	тупить	к опе	ерации	ПО,	дготов	вки	пове	рхності	Ю
части бокорезами в соответствии с ПЭ.  4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			монтир	уемых к	омпонен	нтов.							
4.5.2 В зависимости от вида разъема micro USB произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами. 4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.				4.5.	1 Раздел	лить г	ланку	ШТ	ыревы	X BI	илок	PLS 1	на
произвести выравнивание силовых ножек плоскогубцами.  4.6 Дозированное нанесение припойной пасты.			Ч	асти бок	орезами	в соот	ветств	вии с	ПЭ.				
Д В П         У 3 О         Б А Д				4.5.	2 В зав	висимо	сти от	г ви,	да ра	зъема	a mi	cro US	$ \mathbf{B} $
ДВП УЗО БАД			п	роизвест	ги вырав	вниван	ие сило	овых	ноже	к пло	ског	убцами	.
У 3 O Б A Д			4	.6 Дозиј	рованно	е нанес	ение г	ірипо	ойной	паст	Ы.		
У 3 O Б A Д													
У 3 O Б A Д								ı					
	У  3   О												

								(	OCT 11.	040.019-	-83	Форма 4	4б	
														8
						I						М	жэт 11 02 02	19.797.00.01
												IVII	AЭТ.11.03.03.	.16./6/.000
		-	Т					именование						
		_	Л/M О			Наи	менование дет	али, со.един жание опер						To
		-			1	6 1 I	Томестит	•	`			IOTI I	ио столи	
				Ml	4. икросі			5 3410101	sky iic	чатно	JИ 11J.	іаты і	на СТОЛИ	
					4.	6.2	Установит	гь тюби	ік с	прип	ойно	ой па	астой н	ıa
				pa			нструмент							
				•			ND-35.							
Ц					4.	.6.3 I	Зключить	пневм	олоза	тор	нажа	в на	ь кнопк	·v
				<b>((</b> (	ON/OF				одози	Top				
-					4.	6.4	Вадать ог	тималы	ное и	колич	ество	о до	зируемо	й
				па	асты,	вра	щая руч	ку «Р»	). O	птима	льнь	M (	считаетс	я
				ко	личес	тво,	при ко	тором 1	паста	пол	ност	ью з	заполняє	т
-				ко	энтакт	ную	площадк	у, и при	ЭТОМ	не ра	стека	ается	по мась	æ
				П	ечатно	й пл	ате.							
					4.	.6.5 I	Нанести	несколы	ко п	робнь	IX I	103 [	іасты н	ıa
-				П			ло конта			_				
				-			ания, убе	•		•		•		
							ькой КП.		,	r				
L							Удалить п	побные	лозы	чисто	й сх	хой б	วัสรษю	
							Троизвест	-			•			nR
				ПС			ажатием	_						
					_		ажатием 1-8) в вер:		•	_			-	/Y1
				111	_		_						_	
							Триступи		_		-			
							ечатной і							
				•	зных	-	вмеров,	-			•	ание	следуе	
							ичество д				_			
							нанесенну							й,
				cy			и повтор					мест	о.	
$\Box$					4.	6.9 (	Этключит	ъ авто	матич	іескиї	й п	невм	одозатој	p,
				На	ажав н	а кн	опку «ON	/OFF».						
	В	П								1	ı			
У Б	3 A	ОД												
Л	M	Л												

			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46						
			МИЭТ.11.03.03.18.	707 (					
				/6/.					
		T 	Код, наименование операции  Наименование детали, сб.единицы или материала						
		O	Содержание операции (перехода)						
			4.7 Произвести контроль качества нанесения припойной						
			пасты. Неудачно, нанесенную пасту следует удалить чистой,						
			сухой бязью, затем снова нанести пасту на очищенный участок.						
			4.8 Приступить к операции дозирования клеевой						
			композиции.						
			4.8.1 Закрепить тюбик с клеем на рабочем						
			инструменте дозатора.						
-	+		4.8.2 Включить пневмодозатор, нажав на кнопку						
			«ON/OFF».						
			4.8.3 Настроить дозу клеевой композиции опытным						
		методом, поворачивая ручку «Р». Количество дозы клея							
			должно быть таким, чтобы нанесенный клей на проекцию						
-			середины корпуса, самого мелкого компонента, не						
			растекался на контактные площадки этого компонента.						
-			4.8.4 Запомнить дозировку клея, нажав на						
			произвольный номер программы (номер программы не						
			должен совпадать с номером программы при дозировании						
			припойной пасты) в верхней части дозатора.						
			4.8.5 Произвести нанесение клея, руководствуясь						
			шелкографическим рисунком на заготовке печатной платы.						
			Наносить пасту стоит на середину проекции корпуса на						
			ПП. Количество доз может меняться в зависимости он						
			площади и веса радиоэлектронного компонента.						
			4.9 Произвести контроль качества нанесения клеевой						
			композиции. При наличии растекшегося клея, произвести его						
			очистку чистой, сухой хлопчатобумажной тканью в месте						
			растекания. Затем, повторно нанести клей на это место.						
			4.10 Приступить к сборке компонентов на заготовку						
			печатной платы.						
Ду		Π							
У Б		ОД							
Л	M								
_		_							

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 4б							
			10						
		MIJT.11.03.03.18.78	87.00 OF						
	T	Код, наименование операции							
	Л/М	Наименование детали, сб.единицы или материала							
	О	Содержание операции (перехода)	То						
		4.10.1 Удобно расположить кассеты с компонентами							
		на рабочем месте.							
		4.10.2 В соответствии со сборочным чертежом (СБ)							
		произвести сборку SMD компонентов на печатную плату.							
		Сборка SMD компонентов производится пинцетом. Для							
		удобства работы с мелкими чип компонентами можно							
		использовать микроскоп. Важно учитывать ориентацию							
		некоторых компонентов.							
		4.10.3 В соответствии со СБ произвести сборку							
		традиционно- монтируемых компонентов.							
	4.11 Операция контроля качества сборки печатной платы. Визуально оценить качество сборки, сравнить ПП со сборочным								
		чертежом. При наличии дефектов или несоответствий,							
		произвести подгонку или переустановку компонента.							
		4.12 Монтаж компонентов на плату.							
		4.12.1 Включить термовоздушный паяльный фен, в							
•		составе станции ELEMENT 702 переключив тумблер							
		«ПИТАНИЕ» в левой части паяльной станции в состояние							
		«ВКЛ».							
		4.12.2 Установить на минимум интенсивность							
		воздушного потока, повернув ручку «ВОЗДУХ» в крайнее							
		левое положение.							
		4.12.3 Установить температуру паяльного фена							
		равной 200 °C. Для этого, необходимо установить значение							
		«200» на левом цифровом индикаторе, используя кнопки							
		«ВВЕРХ» и «ВНИЗ», находящиеся под цифровым							
		индикатором.							
Д В П У 3 О									
БАД									
Л М Л									
	ОКУ	Операционная карта универсальная							

		ОСТ 11.040.019-83 Форма 46							
			1						
		MEDITION	10.707.00						
		МИЭТ.11.03.03	.18./8/.00						
	T	Код, наименование операции							
	Л/M О	Наименование детали, сб.единицы или материала  Содержание операции (перехода)	Т						
		4.12.4 Плавными круговыми движениям							
		обрабатывать поверхность печатной платы до начал							
		процесса кристаллизации клеевой композиции. Опытны							
		путем, и методом смещения компонентов пинцетов							
			vı,						
		определить затвердел ли клей.	70						
		4.12.5 Установить температуру термовоздушног	. 0						
		паяльного фера равной 240°С. 4.12.6 Плавными круговыми движениям							
		13							
		обрабатывать ПП горячим воздухом до момент							
		кристаллизации припойной пасты. Момен							
	кристаллизации можно определить визуально, пр								
		паста поменяет цвет и консистенцию.							
		4.12.7 Отключить термовоздушный паяльный фен							
		переключив тумблер «ПИТАНИЕ» в левой части паяльно	М						
		станции в состояние «ВЫКЛ».							
		4.12.8 Дождаться момента, когда печатная плат	га						
		остынет и приобретет комнатную температуру.							
		4.13 Произвести контроль качества монтажа.							
		4.13.1 Произвести визуальный контроль качестн	за						
		паяных соединений.							
		4.13.2 При обнаружении дефекта монтажа следуе							
		провести его анализ и устранение. В процессе устранени	Я						
		дефекта необходимо пользоваться паяльниког	м,						
		присутствующем в составе паяльной станции.							
		4.14 Провести выходной контроль функциональност	ги						
		отдельных узлов ПП. Для этого необходимо использоват	ГЬ						
		универсальный цифровой мультиметр. Порядок работы	c						
		прибором Mastech M9508:							
ДВП УЗО									
У 3 О Б А Д									
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$									
	ОКУ	Операционная карта универсальная	<u> </u>						

Т Кол, нависенование операция  ЛУМ Наисепование астоли, об салинцы или митериала  О Содержание операции (переходая)  То  4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Онт/Иг».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной провержемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и шитапие.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микроехемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микроехемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздупный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			ОСТ 11.040.019-83 Форма 46	
Т Кот, наименование операции  ЛМ Наименование детали, сб.единицы или материала  О Содержане операции (перехода)  То  4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить шупы в гнезда «СОМ» и «V/Оhm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.				12
			MI/FT.11.03.03.18.78	87.00 OK
ММ   Наименование детали, еб.единицы или материала   То		T	Код, наименование операции	
4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ОN».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		Л/М	•	
«ОN».  4.14.2 Установить пупы в гнезда «СОМ» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.  5.2 Термовоздушный паяльный фен отключается при нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.		0	Содержание операции (перехода)	То
нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°С от указанной, для подбора оптимального время кристаллизации материалов.			4.14.1 Включить мультиметр, нажав на кнопку «ON».  4.14.2 Установить щупы в гнезда «COM» и «V/Ohm/Hz».  4.14.3 Повернуть переключатель режимов работы, находящийся в центре прибора, в режим измерения сопротивления (диапазон измерений подбирается индивидуально для конкретной проверяемой цепи).  Проверить функциональность изделия, подключив минимально необходимую периферию и питание.  4.15 Упаковать устройство в тару, передать технологу.  5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ  5.1 Микросхемы собираются на печатную плату с учетом ориентации корпуса, ключ в виде точки на корпусе микросхемы должен располагаться в непосредственной близости к точке на шелкографическом рисунке.	10
	У 3 С Б A Д		нахождении на подставке, поэтому чтобы заработал компрессор необходимо снять рабочий инструмент с подставки.  5.3 Допускается изменять температуру паяльного фена в пределах 20°C от указанной, для подбора оптимального время	
		_		



								ГОСТ 3	3.1118-8	32 Ф	орма 4			
												7		1
										МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	37.00	MK
		М	одуль	програ	MMM	nuem	OEO EM	роста	бипиз	atona				
	В	Цех	Уч	PM		пер	ого ги			вание оп	ерации			
	Γ			1	(	- Обознач	нение дог	кумента						
	Д	CM	TT 1				ование о			TC	T =	T		
	Тп.з Л/М	CM	Проф	Р Наимеі	УТ новани	КР е летал	КОИД и, сб. еди	ЕН	ОП пи матер	К <sub>шт</sub> иала	Тп.з.	Тшт		
	H/M		Об	означени		дотак	., • • • • • •	ОПП	EB	EH	КИ	H <sub>pacx</sub>		
	01	1		1										
	Γ 02	Настоя	щий	мар	шрут	<u>Ι</u>	опред	еляет	П	ослед	овател	ьность		
	03	выполн		1			1			1		1		
	04	модуля		1			1	-		1	1	1		
	05								1			1		
	Γ 06	ГОСТ 1	12.3.03	2-84, 1	OC	12.3	.002-7	75				1		
_	07	1										1		
	Γ 08	1	. Общ	ие тех	ниче	ские	требо	вания.			1	1		
	09	1.1. Печ			!	!	!		:	и монт	аж. ло	і ЛЖНЫ		
	10	соответ												
	11	ГОСТ2		1	1	1	1		1	1	1			
	12	отметко										1		
		1.2. Bc		1	1	1	1		1	DRy.		1		
	14	(электр		1			1			бороч	ные уз	шы)		
	15	должны		1	1	1	1		:	1	1	1		
	16	соответ								_	І П			
	17	констру		1	1	1		iwi yesi		VI FIJIFI				
	 18	1.3. Ha		1	1	1	1	шие из	елепия	т попж	HLI	1		
	19	находи		1	. 10 KC		1	TIIO II	.д. <b>-</b> л. 1117	. доли		1		
	20	1.4. Пр		-	и nal	От 33	преш	ается	испол	<b>LSUBS</b> 1	Ъ	1		
	21	неиспр		1	1	1	1		1	ושפטכעו	ע	1		
	22	1.5. Of		ипотр	y MCE	OHOUT	mecko	a octro	y. ICTV2 1	и спел	СТРЗ			
	23	измере			1		1		1			ПИ		
	23	измере	шил, Щ	PHIMICHY	I CIVIDI	С ДЛЯ	ъвито.	тисни.	n one	лации	Соорки	1 Y1		
	۷ <del>11</del>													
					1		Разраб			ов Д.И				
					+		Провер		Вино	градов А	.И.			
					+		Утверд Н.конт				$\overline{}$			
							тт.коп1	۲۰						
	 МК					Марші	рутная ка	арта						
						r		•						

 						ГОСТ 3	3.1118-8	32 Форм	иа 3б		
											2
-								МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
В	Цех	Уч.	PM	Опер			наимено	вание оп	ерации		
ГД				Обозна Код, наимен		окумента	апиа				
E	CM	Проф	P	УТ КР	коид		ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
Л/М			Наиме	енование дета.	пи, сб.ед	иницы ил	и матер	иала			
H/M	1	Об	означени	е, код	1	ОПП	EB	EH	КИ	H <sub>pacx</sub>	
1	и монт	гажа пл	ат, дол	іжны быт	ь атте	стован	ы.			1	
2	1.6. Пр	ои выпо	лнени	ии работ с	облю	дать тр	ебова	ния по	защи	те от	
3	статич	еского	электр	оичества і	и рабо	тать с	антис	татиче	ским		
4	брасле	стом в с	оотве	гствии с т	ребов	ваниям	и ГОС	CT 12.3	3.032-8	34.	
5	1.7. До	начала	а рабо	ты по мон	тажу	плат п	ровер	ить те	мпера	гуру	
6	воздух	ка термо	і овозду	шной пая	і льной	і станц	; (ии. В	еличиі	на	1	
7	превы	шения	над те	мператур	ой нач	нала кр	истал	лизаці	ии при	ПОЯ	
8	(45-80	) °С зав	висит (	от массы 1	аяем	ого изд	целия,	време	ни пай	іки,	
9				іловому в						1	
10				иях (ТУ) н			l		1	1	
11				ы LFM-48			мпера	атура н	ачала	1	
12				оответств						М.	
13				ура пайки		1					
14				ого клея J							
15				ется 170 °							
16				ь увеличе						1	
17				а воздуха		1_		чена с	)T	1	
18				ления при			1			1	
19				чем 20-30			1			1	
20	1			годом и ра		1	1		l	1	
21		нтами).			1						
22			иперат	гуры возд	VIIIHOI	го потс	ка пр	оизвол	ится	1	
23				луры возду Мовоздуш:						ЭННЫМ	
24				гка об уст						1	
25				ся в журна				ратур	Возд	I	
26	HOTORU	произ	одит	и в журпс	inc Ro	11170317				1	
20											
МК			Ma	аршрутная кар	та						

								ГОСТ	3.1118-	-82 Фо	рма 3б		
													3
	1									МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM	Oı	тер		Код,	наимено	вание оп	ерации		
	Γ						нение дог						
	— <u>Д</u> Е	CM	Проф	P	Код, 1	_	ование о КОИД	оорудов ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М	CIII	11704						пи матері		11115	- 1111	
	H/M		Об	означени	е, код			ОПП	EB	EH	КИ	H <sub>pacx</sub>	
	1	Время	оплавл	і Іения і	трипс	ойной	і пасті	ы и те	ермиче	еской (	брабо	ТКИ	
	2	клея по									1		
	3	качест									1		
	4	1.10. T	ребова	ния к ч	услов	зиям :	произі	водст	н Ва и пр	завила	ιих		
	5	соблюд									1		
	6							1210			1		
	B 7				005		Комг	ілекто	овочна	ія			
	8	1					1101111				1		
	Γ 9	ГОСТ	12.3.03	32-84.	ГОСТ	Г 12.3	3.002-	75			1		
	10	1	12.0.00	1		120		, c			1		
	Д 11	Стол м	онтажі	ника Р	ЭА А	PM-	4110				1		
	12										1		
	T 13	Брасле	ет анти	статич	ески	й ЈТ-	97-081				1		
<u> </u>	T 14		ехноло								1		
	15	1		1							1		
	Γ 16	Опера	цию пр	) ОВОЛИ	ть с с	собль	оление	ем тре	ебован	ий ГО	CT 12.	3.002-	
	17	75	<u> </u>	Говодп			эдоппо	111 150				2.002	
	18	13		1							1		
	O 19	Компт	іектова	TE HOU	еппа	COPTO	OCHO CI	теппл	MKSIII	TTX	I		
	20	IXUMIIIJ	ICKIUBA	то изд	KINILO	COLII	icho Cl	тециц	ункац!	ırı.	1		
	_	Пест			0 ===	WILL T	OMOTE	T IT CONTINUE		0.110.1111	בית ב		
			рить пе				_						
	22		схемы										
	23	1	тветсті	1					-				
	24		ентов,	ŀ				однос	ть и с	рок вь	іпуска		
	Γ 25	Разлох	кить ко	мплек	туюц	цие в	тару.				1		
	26												
	MK			Ma	ршрутн	ная кар	та						

								ГОСТ	3.1118-	-82 Фо	орма 3б		
													4
										МИ	ЭТ.11.0 <del>.</del>	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM		іер			наимено	вание ог	герации		
	<u>Г</u> Д						нение до		a				
	E	CM	Проф	P	УТ		КОИД	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М			Наиме	новани	е детал	и, сб.еди	ницы ил	и матер	иала			
	H/M		Об	означени	е, код		1	ОПП	EB	EH	КИ	H <sub>pacx</sub>	
	Γ 1	На пок	зупные	ЭРЭд	должі	на бы	іть соі	провод	цителі	ьная д	окумен	тация	
	2	о прохо	эждени	и вход	дного	конт	роля (	соглас	но тр	ебоваі	ниям Г	OCT	
	3	12.3.03	2-84.	İ			İ	İ			İ		
	4						i	i			i		
	B 5				010		Подг	отовк	а ПМ	К			
$\vdash$	6												
	T 7	Бокоре	зы ТО]	PEX 3	2D10	6							
	8	1											
	O 9	Произн	вести п	азлепе	ение і	тпань	си PLS	5-40 н	а част	ивсо	ОТВЕТС	гвии	
	10	со спе				main			1401	пъсс	I		
	11		тфтка	щиси.							1		
	B 12	1			015		Опис	стка п	-иятиі	лу ппа	) AT		
	13	1			013		O III	I Ku II	o lallil	317X 1131C	11		
	Л 14	Спирт			ктифі							ГОСТ	
	15	P 5587			Пифи	IKODa	IIIIIDIYI	CAIII	-ICCRP	in wor		001	
	Л 16				ONCHI	10 00	пфоти	TT (400	×400)	NOV. C	200*20	0) 204	
	17	Ткани			ажны	ic, ca.	пфетк	и ( <del>4</del> 00	(X <del>4</del> 00)	мм, (.	<u> </u>	U) MM	
		ГОСТ	<u> </u>	03	1 1						1		
	18	1 17									1		
	O 19	_									лфетки	l,	
	20	предва		İ			i .	i .			1		
	O 21	2. Про	сушиті	ь платі	ы, исі	польз	зуя хло	опчато	бума	жную	ткань.		
	22										1		
	B 23				020		Нане	сение	прип	ойной	і пасты	[	
	24										1		
	Д 25	Полуан	втомати	ически	ій про	ВМОД	отато	p ND-	35.				
	26				. ,					•			
		•											
	МК			Ma	іршруті	ная кар	та						

,								ГОСТ	3.1118	-82 Фс	рма 3б		
													5
										МИ	ЭТ.11.03	3.03.18.78	87.00 MK
	В	Цех	Уч.	PM	Oı	іер		Код,	, наименс	вание оп	ерации		
	Γ							кумента					
	<u>Д</u> Е	CM	Проф	Р	Код, в УТ		ование о КОИД	оборудог ЕН	вания ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
	Л/М	Civi	Проф				/ 1		ли матер		111.5	1 IIIT	
	H/M		Об	означени				ОПП		ЕН	КИ	H <sub>pacx</sub>	
	O 1	1. Про	извести	і и нане	сение	приі	тойнс	рй пас	ты LF	M-48L	J MDA	<u>-</u> 5	
	2	полуав		1				1			1		
	3	Нанес		l	1 1				i i	l		КУ	
	4	всех ко						1					
	5	площа,									1		
	6	111101114,	Ann on				рине				1	1	
	B 7				025		Сбор	- эка Т1	ИК и I	ІМК	1		
	Д 8	Полуаг	втомати	ически	ій пре	ВМОД	озатс	p ND	-35.		1		
	9	1		1							1		
	O 10	1. Уста	новить	тюби	кскј	<b>пеем</b> 1	на соі	пло пі	невмат	ическо	т ОГО ДОЗ	ватора.	
	O 11	2. Про	извести	і и нане	сение	клея	на п	ечатн	ую пла	: атув м	еста		
	12	крепле		l .							1		
	O 13	3. Про				ирова	ние к	омпо:	нентов	в на пл	ате в		
	14	соотве	тствии	с черт	ежом	т МИ	ЭТ.11	.03.03	3.18.78	7.00.0	0 СБ.		
	O 15	4. Нагр	эеть па	яльны	й фен	г до т	емпер	атурі	ы 170-	200 °C	 ( ′•		
	O 16	<ol><li>Уста</li></ol>	новить	ОПТИР	мальн	гую и	нтенс	: СИВНО:	сть по	: гока го	і эрячего	) )	
	17	воздух		1							1		
	O 18	6. Пос		) 0 pa30]	греть	печа	ГНУЮ	плату	в мес	тах кр	еплені	RK	
	19	КОМПОН								•	1		
	20										1		
	21							l					
	22	1									1		
	23	1									1		
	24	1		l				1	1		1		
	25												
	26	1									1	1	
		<u> </u>											
	МК			Ma	ршрутн	іая кар	та						

									ГОСТ	3.1118-	-82 Фо	рма 3б		
														6
											Ми	'TT11 ()	2 02 10 7	97 00 NATA
		_											3.03.18./	87.00 MK
		<u>В</u>	Цех	Уч.	PM		пер				вание оп	ерации		
		Д						вание до						
		E	CM	Проф	P	УТ		коид	ЕН	ОП	Кшт	Тп.з	Тшт	
		Л/М			Наиме	еновани	е детал	и, сб.еди	ницы ил	ти матері	иала		•	
		H/M		06	бозначени	іе, код			ОПП	EB	EH	КИ	H <sub>pacx</sub>	
		1			!	030		Конт	роль 1	качест	ва сбс	рки	!	
		2		I	1	1			I	1	I	1	1	
		Д з	Микр	оскоп А	льтам	и LC	D			1		1		
		T 4	Скалі	ьпель мо	нтажн	ный э.	лектр	отехн	ическ	сий.				
		5			1							1		
ŀ		O 6	1. Пре	оизвесті	і и контр	оль і	качес	гва мс	нтаж	а изде	лия, и	 СПОЛЬЗ	вуя	
		7		овой ми						1		1	1	
		8		дены в						1		1		
		O 9	2. Пр	и обнар	ужени	и не н	качес	гвенно	ого по	зицис	они <b>р</b> он	зания		
		10	_	нализир		1					_		ядке:	
ŀ		11		атно по								1	1	
		12		девшег										
		13	повто	рную с	борку	этого	комг	онент	га на 1	течатн	іую пл	ату.		
_		14												
		B 15			1	035		Монт	гаж П	МК и	ТМК			
		16												
		Д 17	Паяп	ьная ста	ниия Е	ELEM	IENT	702		1				
		18	1100101	511471 <b>C</b> 14	111111111111111111111111111111111111111		LLIVI	702		1		1	1	
Т		O 19	1. Pas	вогреть	паяпьн	ый ф	ен. ло	) темп	ienaty	ры 22	0-240	°C.	1	
		O 20		гановит						Î			0	
	+	21	возду			.1471DI	1 10 H	1110110	1151100	15 110	. Onu IV		1	
		O 22		ли. степенн	(O 1)830	грева	ть ко	мпоне	нты і	по нач	ала ог	і ілавпеі	ния	
		23		ойной п	1	Грева	LD RO	.1110110	, 1	10 114 1				
	+	23	приш	omion II	ac IDI.	1				1		1	1	
		25				1				1		1		
		26			1					1		1	1	
		20												
	•	МК			Ma	аршруті	ная кар	га						

